

# 專利申請實務

翼勝專利商標事務所  
高雄分所

ESSEN Patent & Trademark Office  
臺北、臺中、高雄、上海、深圳



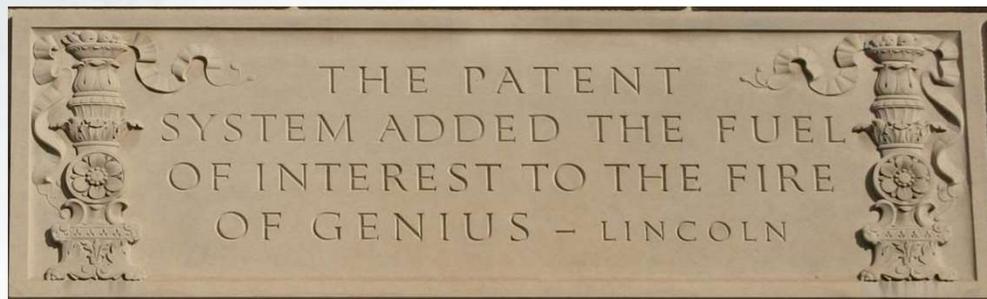
# Outline

- 專利制度回顧
- 大專院校的專利策略
- 專利申請簡介(以台灣為例)
- 專利檢索簡介

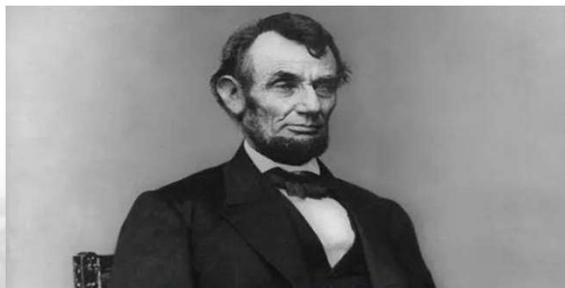


Philips概念路燈 光合之花 Light Blossom 太陽能/風力發電

# 專利制度回顧



專利制度是給天才之火加上利益之油料



鑄刻在美國商務部大門的林肯總統名言

在美國歷任總統中，林肯是唯一獲得過專利的  
--- 專利號6469:讓船隻在淺水區漂浮的方法」  
(A device for buoying vessels over shoals)

# 專利權是智慧財產權的一種



經濟部智慧財產局



智慧財產法院  
Intellectual Property Court

- ▶ 依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。【智慧財產法院組織法 § 3】

# 專利權是用智慧換財產的權利



腦中突然閃過的簡單概念  
具體可行的技術方案  
申請專利之雛形



# 專利權之目的

目的：為鼓勵、保護、利用發明與創作，以**促進產業發展**

- 1.可保障申請人於一定年限內具有**專有的權利**，  
給予可能獲得報酬的機會，激發創新意願。
- 2.公開發明內容，供給大眾作為發展更新之產業技術的**改良參考**，  
並**防止重複研究**。



紐西蘭馬丁發明的噴射背囊概念



M200X Volantor 飛碟型漂浮交通工具  
made by US Moller

# 專利權的特性

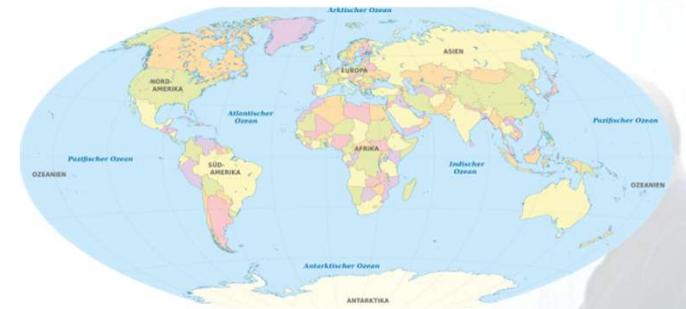
## 特點： 排他性

- 專有**排除他人**未經其同意而**實施**發明之權
  - **製造、為販賣之要約、販賣、使用**或為上述目的而**進口**物品
  - **使用方法；使用、為販賣之要約、販賣**或為上述目的而**進口**該方法直接製成之物

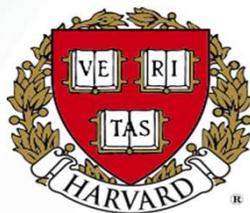
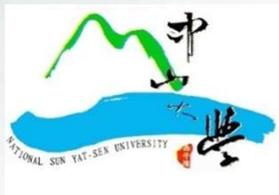
## 地域性

- **屬地主義**(各個國家各具不同專利法制)

**時間性**(專利**有效期間**內，才擁有專利權)



# 大專院校的專利策略



# 大專院校何不申請專利

## 好處眾多、國際趨勢、不可不知

### ➤ 學校、教授或學生申請專利之好處：

- ✓ 學校知名度免費**宣傳**效果
- ✓ (每年專利申請排名，國際發明展)
- ✓ 教育部對學校之**評比**及**補助**
- ✓ 科技部**補助**學術研發成果
- ✓ 教授評鑑**績效**
- ✓ 學生升學**甄試**
- ✓ 學生畢業求職資格**審查**研發能力
- ✓ 學校及發明人**技轉/授權金**
- ✓ 學校經費自籌來源之一

110 年本國法人專利申請百大排名

單位：件數

排名	ID	申請人中文名稱	發明	新型	設計	總計
1	22099131	台灣積體電路製造股份有限公司	1,950	0	0	1,950
2	84149738	友達光電股份有限公司	460	4	7	471
3	20828393	宏碁股份有限公司	312	55	95	462
4	22671299	瑞昱半導體股份有限公司	440	0	2	442
5	02750963	財團法人工業技術研究院	392	11	1	404
6	89390656	南亞科技股份有限公司	290	0	0	290
7	84149961	聯發科技股份有限公司	249	12	0	261
8	04322046	英業達股份有限公司	230	3	0	233
9	30414175	中國鋼鐵股份有限公司	125	86	0	211
10	34051920	台達電子工業股份有限公司	163	30	12	205
11	04541302	鴻海精密工業股份有限公司	180	20	2	202
12	21222725	仁寶電腦工業股份有限公司	146	9	39	194
13	23638777	華碩電腦股份有限公司	76	102	7	185
14	29902611	城市學校財團法人臺北城市科技大學	7	163	0	170
15	03705903	兆豐國際商業銀行股份有限公司	25	140	0	165
16	22822281	廣達電腦股份有限公司	59	83	19	161
17	03077208	中國信託商業銀行股份有限公司	39	116	0	155
18	70799128	合作金庫商業銀行股份有限公司	11	133	0	144
19	87557573	國立陽明交通大學	135	6	0	141
20	28689155	和碩聯合科技股份有限公司	123	17	0	140
21	28112646	新唐科技股份有限公司	132	6	0	138
22	96979933	中華電信股份有限公司	135	1	0	136
23	22099548	旺宏電子股份有限公司	131	1	0	132
24	28112667	力晶積成電子製造股份有限公司	116	0	0	116
25	75370905	南亞塑膠工業股份有限公司	101	13	0	114
26	69115908	國立成功大學	102	8	3	113
27	54297090	巨鎧精密工業股份有限公司	3	0	109	112
28	12868358	緯創資通股份有限公司	86	25	0	111
29	73502016	遠東科技大學	32	76	0	108
30	22099218	華邦電子股份有限公司	103	0	0	103

# 大學技術之產業化

## 讓大學的專利貼近產業所需

### ➤ 大專院校專利申請策略建議：

1. 論文主題建議設定在**解決產業技術發展所面臨問題**之相關研究
2. 在決定論文主題之同時最好已進行過**專利檢索確保可專利性**
2. **積極申請美、歐、日、中等主要國家專利，擴大專利整體價值**
3. 儘量在論文**公開(口試)前**預先申請專利，以免不符外國專利法規定
4. 進行**同一主題大型研究計劃**，並策略性產出專利地雷網
5. 對國內外企業**積極進行授權、轉讓**，甚至提出侵權訴訟

四億元 成大創下台灣技轉金新紀錄 張明熙教授研發骨質疏鬆新藥 技轉歐洲第二大藥廠諾和諾德



# 大專院校如何申請專利

## 提出論文成果同時應即申請專利

### ➤ 實務操作方式:

#### 論文發表前申請專利

TW專利法:優惠期→公開之事實發生後

(發明/新型:12個月)(設計:6個月)

US專利法之規定為一年,但有些國家沒有此類優惠或有條件限定

申請費用多由學校全額負擔,並有事務所配合協助撰稿及申請事宜 (但美國專利申請之校內審查相對較嚴格)

專利申請或核准,教授或學生可能獲得發明獎金

科技部補助計畫可申請專利補助金

申請專利相關費用:60%; 維護專利相關費用:50%



# 專利和論文相似?



PS1. 專利名稱與論文名稱命名慣用方式稍有差異，專利名稱應當簡短、準確地表明發明專利申請要求保護的主題和類型，字數不超過25字，不像論文名稱常寫得十分詳細

PS2. 論文較側重實驗方法,材料選用或數據設定;與專利對結構或步驟特徵的要求,不儘然相同,故**可發表論文/期刊的技術,不代表一定能申請專利**

# 專利和論文相異？

## 研發收入 v.s. 研發支出

- 論文或期刊：  
論文和期刊是保護一新技術可能產生之**潛在學術地位**
  - 專利：  
專利是保護一新技術可能衍生出之**潛在商業價值**  
(不申請專利,可能將研發成果免費送人使用)
  - 教授與研究生(發明人)：  
熟悉實驗及技術原理，但對專利申請實務不熟悉
  - 專利事務所(專利工程師)：  
熟悉專利申請流程及說明書撰寫格式，但需由教授及研究生協助提供足夠之技術內容
- ⇒ 學校**發明人**與**專利事務所**需**相互配合**，以藉由雙方之專業長處得到最佳品質之專利申請案



# 申請專利時要提供什麼？

## 以第一次提出TW專利申請為例

➤ 教授或學生提供下列資料：

創意構想相關申請表

(含先前技術缺點、本發明特徵技術、產生之功效及相關圖例等)

論文或期刊

(儘量為中文本，否則可能增加**服務費用**及撰稿時間)

➤ 學校委託之專利事務所提供下列文件：

委案後完成**專利說明書**及**必要圖式**

註：上述資料大多不需過度詳細之實驗數據

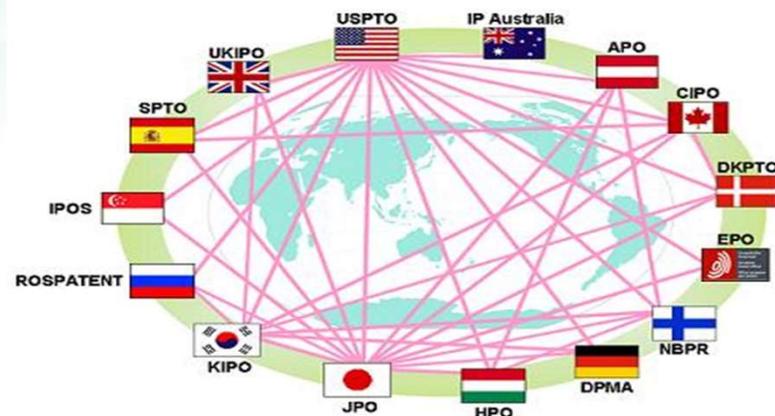
(與化學或生化相關者則需要製備方法與實驗組/對照組數據供證實效用)



# 專利保護有地域限制-

不能劃地自限，應放眼國際佈局

- 在TW申請的專利，只能保護在TW境內之專利排他權
- 欲保護在US、CN、JP或EP等地區之專利排他權，則要分別到US、CN、JP或EP申請專利 (EPO:34成員國和4延伸國)
- PCT(專利合作條約:157締約國),TW需通過CN、US或其他締約國申請



# 專利佈局考量

## 你的專利申請在對的地方嗎？

### ➤ 如何抉擇是否申請？

對於未來潛在的銷售市場、製造地，或可能的競爭對手所在地，都應考慮進行專利佈局

### ➤ 市場愈大的地區，申請專利之潛在商業價值愈大 (愈容易發生大金額之侵權／授權案件)



21CN 社区

pandaxpp.blog.163.com

=> 假設你有一個專利被Apple侵權了

Q1: 你的專利是那一國的專利？

Q2: 你想把它賣給誰最好？

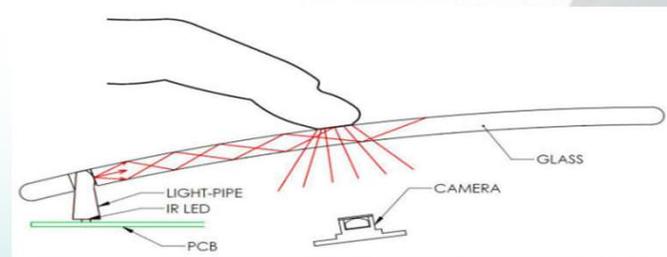
Apple、Samsung、HTC、Google？

(專利戰場上沒有永遠的敵人或朋友)

# 申請外國專利時要提供什麼？

## 就已有TW專利說明書而言

- 若已有TW專利說明書：  
只需提供台灣案中文說明書與圖式之電子檔  
再由事務所翻譯即可
- 需注意在TW專利申請後**12個月內**完成US專利申請
- 關於化學或生化專有名詞：  
化學或生化專有名詞，最好主動提供英文全名



全玻璃觸控滑鼠/鍵盤

# 職務上的發明

## 案例：

黃教授所主持的國科會補助研究計畫「OOO技術」，該技術的發明人為黃教授，但是黃教授所任教的該大學，擁有該發明專利的專利申請權，由該大學向經濟部智慧財產局申請發明專利，如經該局審定核准公告，將由該大學獲得該技術的發明專利權。

- 大學校院教師執行政府機關補助、委辦或出資之研究計畫，該計畫所衍生之發明或創作，原則上執行該計畫的教師是發明人或創作人，但是該教師所任教的大學校院，擁有該發明或創作的專利申請權，由該大學校院向經濟部智慧財產局申請專利，如經該局審定核准公告，將由該大學校院獲得該發明或創作的專利權。
- 大學校院教師，如非執行政府機關補助、委辦或出資之研究計畫，而係利用該校資源完成之研究成果，其所衍生之專利權歸屬問題，各大學校院得參酌「科學技術基本法」第六條、行政院國科會所訂「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第十三條之精神，自訂該校相關辦法，以規範研發成果歸屬學校所有或教師個人所有，以及成果運用收入分配之比例，並建立授權與技術移轉及推廣機制、侵權行為處理機制等，以保障及推廣研發成果，鼓勵創新研發。
- 大學校院教師，如非利用學校資源完成之研究成果，其所衍生之專利權歸屬問題，應與補助、委辦或出資之私人企業或機構簽訂契約，於該契約中明文約定，其所衍生之專利權歸屬該私人企業或機構所有，或歸屬該教師個人所有。

# 專利申請程序(以台灣為例)



# TW申請專利種類



經濟部  
智慧財產局

專利種類	發明	新型	設計(外觀)
法定標的	物品、物質、方法、用途(功能性,具體、抽象)	物品(功能性,具體)	物品外觀 (裝飾性,具體)
國際優先權	12個月	12個月	6個月
早期公開	申請日之次日起 滿18個月公開	無	無
審查流程	程序審查 3年內請求實質審查	程序審查 形式審查	程序審查 實體審查
專利權期限	申請日起 20年	申請日起 10年	申請日起 12年
案例	背光模塊構造、 液晶驅動IC測試方法、 液晶材料、藥物轉用	電腦主機、滑鼠、鍵盤 等之構造改良	電視機殼、手機殼、遊戲機 殼、 眼鏡、燈飾之外觀

# US專利種類

## (什麼標的可以申請什麼US專利?)

專利種類	發明 Utility	設計 Design	植物 Plant
法定標的	方法、機器、物質、用途(具體、抽象)	物品外觀(裝飾性)	植物品種
國際優先權	12個月	6個月	12個月
早期公開	申請日之次日起 滿18個月公開	無	無
審查流程	程序審查 實質審查	程序審查 實質審查	程序審查 實質審查
專利權期限	申請日起 20年(需繳年費)	核准日起 14年(不需年費)	申請日起 20年(需繳年費)
案例	背光模塊構造、 液晶驅動IC測試方法、 液晶材料、威而剛	LCD外殼、 手機殼、遊戲機殼、 眼鏡、燈飾	無性生殖培植出的變形 芽、變體、雜交及新發 現的種子苗

台灣人申請多以<發明專利>為主，如果要申請美國專利的話，需注意在TW申請後12個月內完成美國申請(優先權)

# 發明專利(Invention)

## 發明：

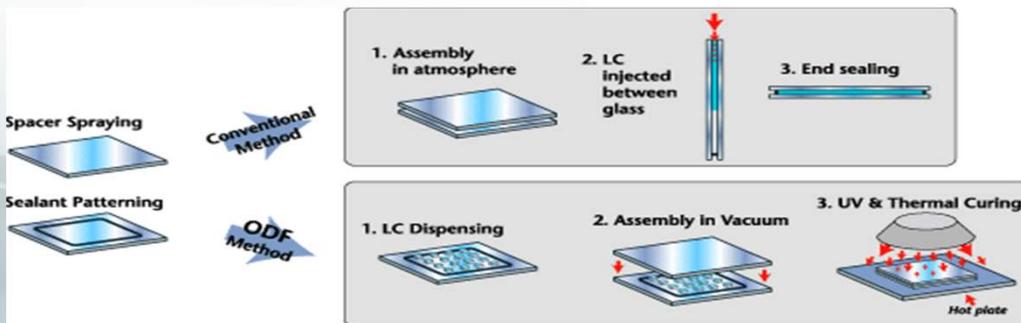
一發明，指利用自然法則之技術思想之創作。

**物**之發明：分為**物質**及**物品**，例如機器、設備、儀器、裝置、系統、組合物、化合物等。

**方法**發明：分為物的製造方法及無產物的技術方法，例如製造方法、加工方法、測試方法

**用途**發明：物的新用途，特別是化合物的新用途

=> 皆需有別於現有產品或方法，並產生非顯而易見之效果。



液晶灌注  
ODF制程(方法)



透明顯示器指甲手錶  
概念(產品)

保髮止/柔沛  
(用途轉用，  
原治療攝護腺肥大)



# 發明專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

18個月

早期公開

只是公開，不代表已核准

申請日起3年內主張

實質審查

檢索確認是否已存在  
相同(相似)技術

約0.5~3年

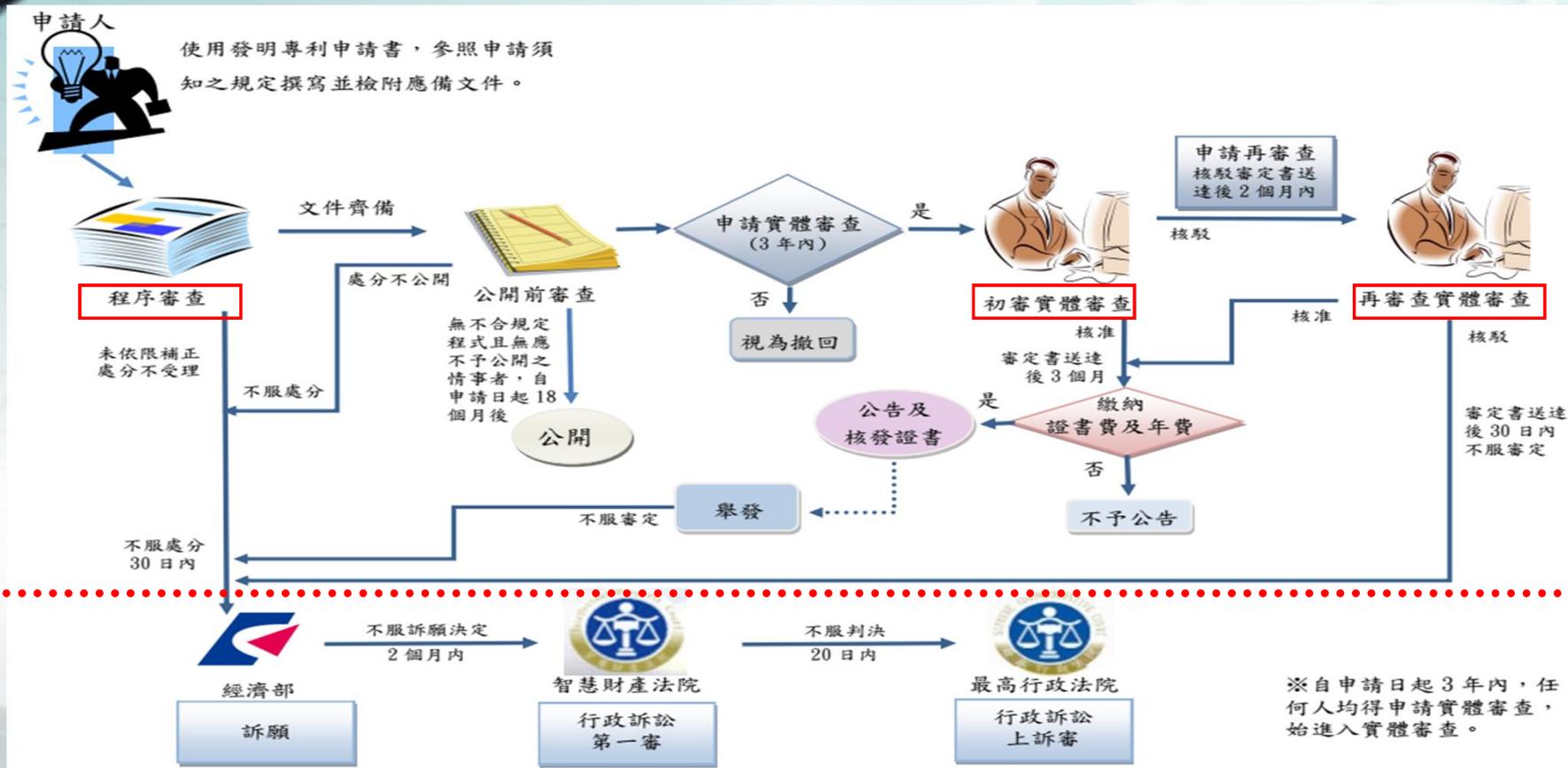
專利核准

也可能在早期公開前  
就已核准

專利公告

公開與公告號規則不同  
公開號: 200623277  
公告號: I319906  
(Invention)

# 發明專利申請及行政救濟程序



摘自經濟部智慧財產局網站

# 新型專利(Utility Model)

## ▶ 新型：

—新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之**形狀**、**構造**或**組合**之創作。

新型：物品為具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓者。新型物品須具有確定之形狀與發明/外觀設計的不同點：**只限於有一定形狀的產品(具體且有功能性)**，而不能是：氣態、液態、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或材料；或物品之形狀及其表面之圖案、色彩、文字、符號或其結合之裝飾性設計。



太陽能充電式LED手電筒



瑞士Peraves公司的全封閉式摩托車

# 新型專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

約2~6個月

專利核准

專利公告

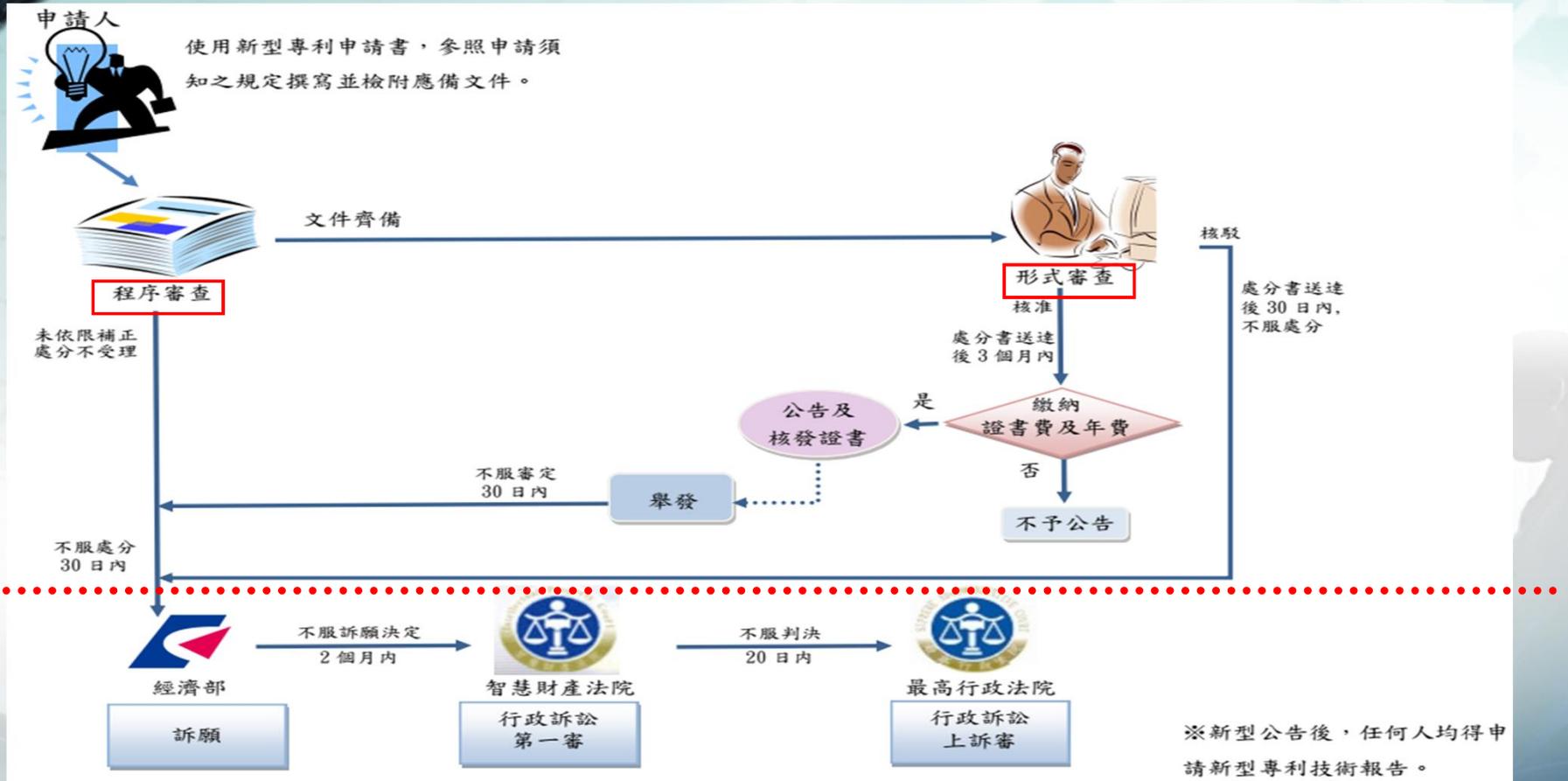
只有公告號、沒有公開號  
公告號: **M329611**  
(Utility Model)

(非必要)

新型專利技術報告

行使專利權(訴訟)時  
需主動提示技術報告

# 新型專利申請及行政救濟程序



摘自經濟部智慧財產局網站

# (外觀)設計專利(Design)

## ▶ 設計專利：

—設計專利，指對物品之**形狀、花紋、色彩或其結合**，透過**視覺訴求**之創作。

## ▶ 特點：

- 1、**物品性**：必須為應用於物品外觀之具體設計，以供產業上利用。
- 2、**視覺性**：必須是透過視覺訴求之**裝飾性**設計。



水果造型便條紙



iPhone 外殼

Pretec I-Disk Sushi  
握壽司造型隨身碟

# 設計專利簡要申請程序

專利申請

約6~12個月

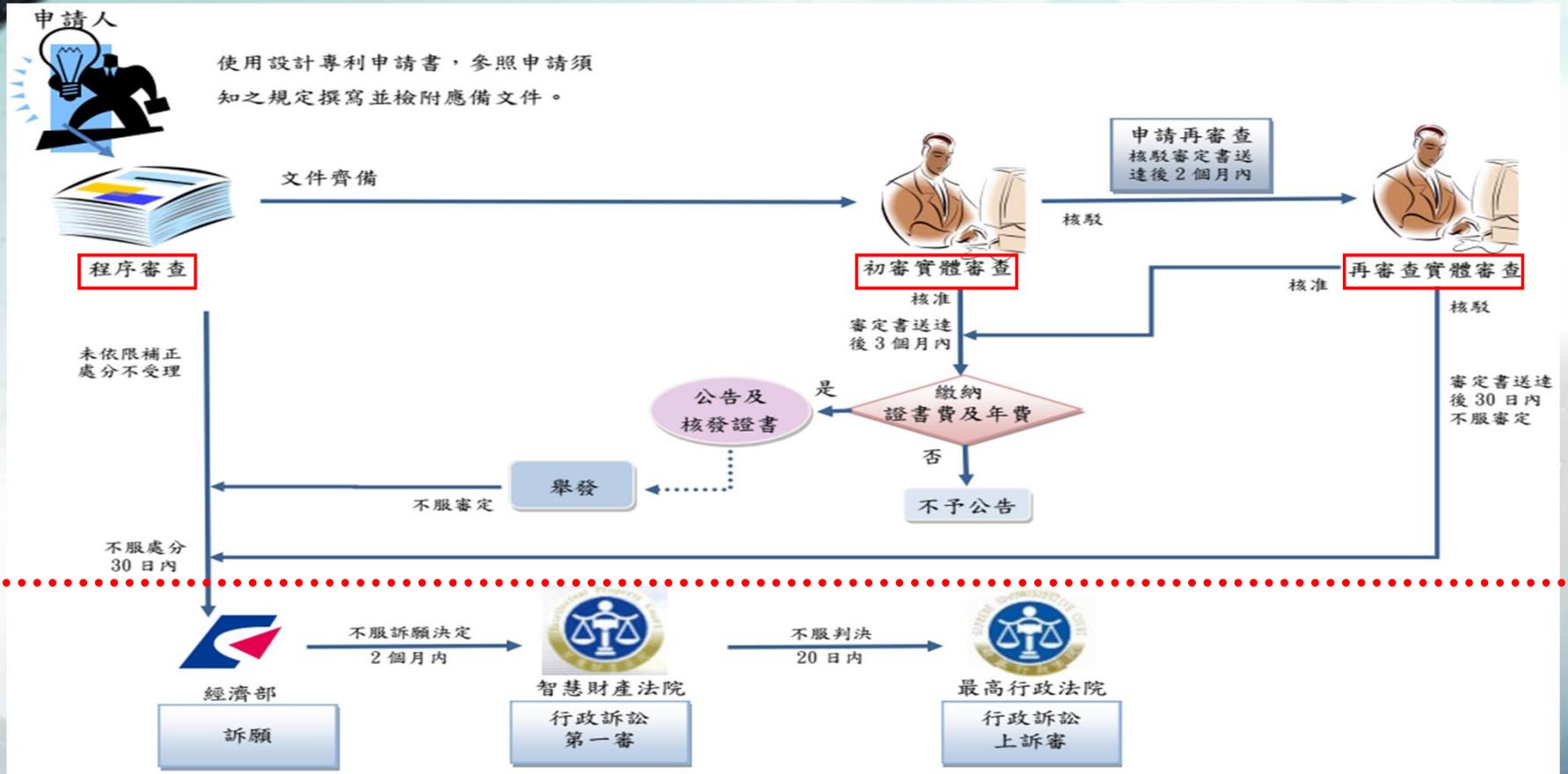
實體審查

專利核准

專利公告

只有公告號、沒有公開號  
公告號: **D139301**  
(Design)

# 設計專利申請及行政救濟程序



摘自經濟部智慧財產局網站

# 那些標的不可申請發明專利?

## ☹️ 自然法則本身

(例如能量不滅定律或萬有引力定律)

## ☹️ 單純的發現

(例如自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現)

## ☹️ 違反自然法則者

(例如永動機構)

## ☹️ 非利用自然法則者

(例如人為規則、方法或計畫；或須藉助人類推理力、記憶力始能執行之規則、方法或計畫)

## ☹️ 非技術思想者

(技能：球投法；資訊揭示：手語；  
美術創作：繪畫、雕刻)

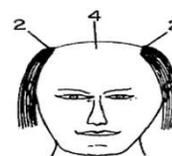
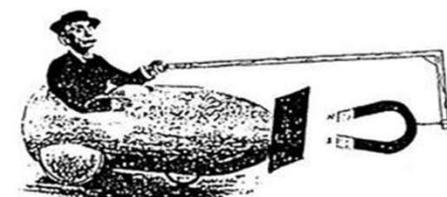


FIG. 1



FIG. 5



V.S.



# 法定不予發明專利

下列各款，不予發明專利：



V.S.



☹️ **動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。**  
但**微生物學之生產方法**，不在此限。

☹️ **人類或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法(器具除外)。**

☹️ **妨害公共秩序或善良風俗者。**

破解彩券之中獎方法？



# 先申請主義(以發明為例)

➤ 相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其**最先申請者准予發明專利**。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

前項申請日、優先權日為**同日**者，應通知申請人**協議**定之；協議不成，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。

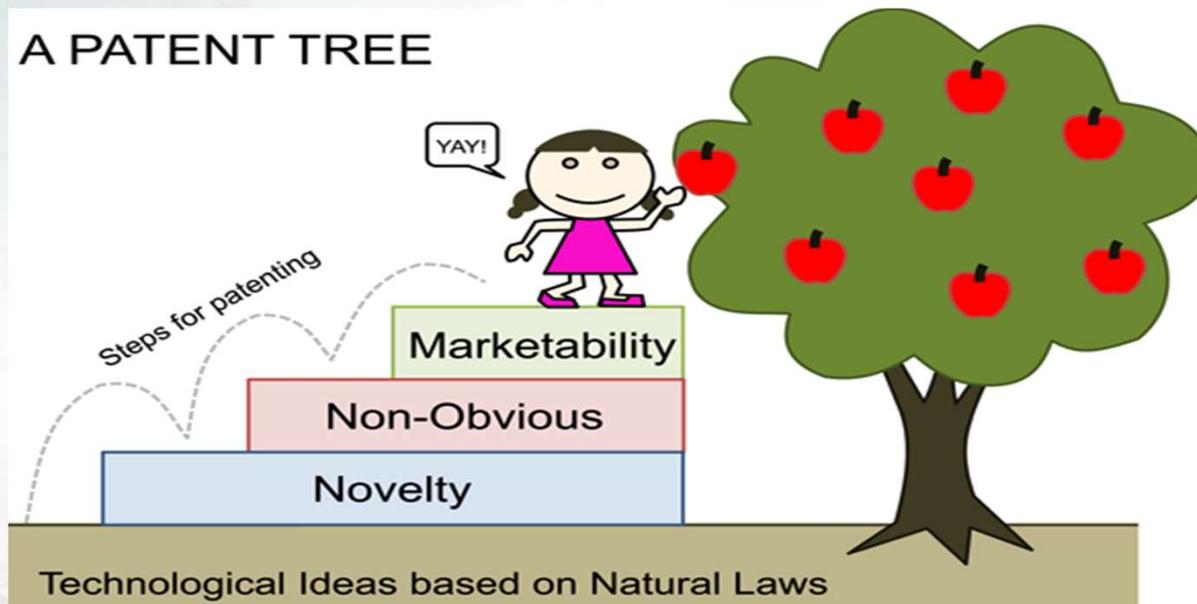
聲明**一案兩請**，新型與發明專利權之**權利接續**

假設兔子先想到發明概念，  
但烏龜卻搶先一步較早申請，則：  
在台灣(或大多數國家地區)，烏龜贏！(但在美國,可能是兔子贏)

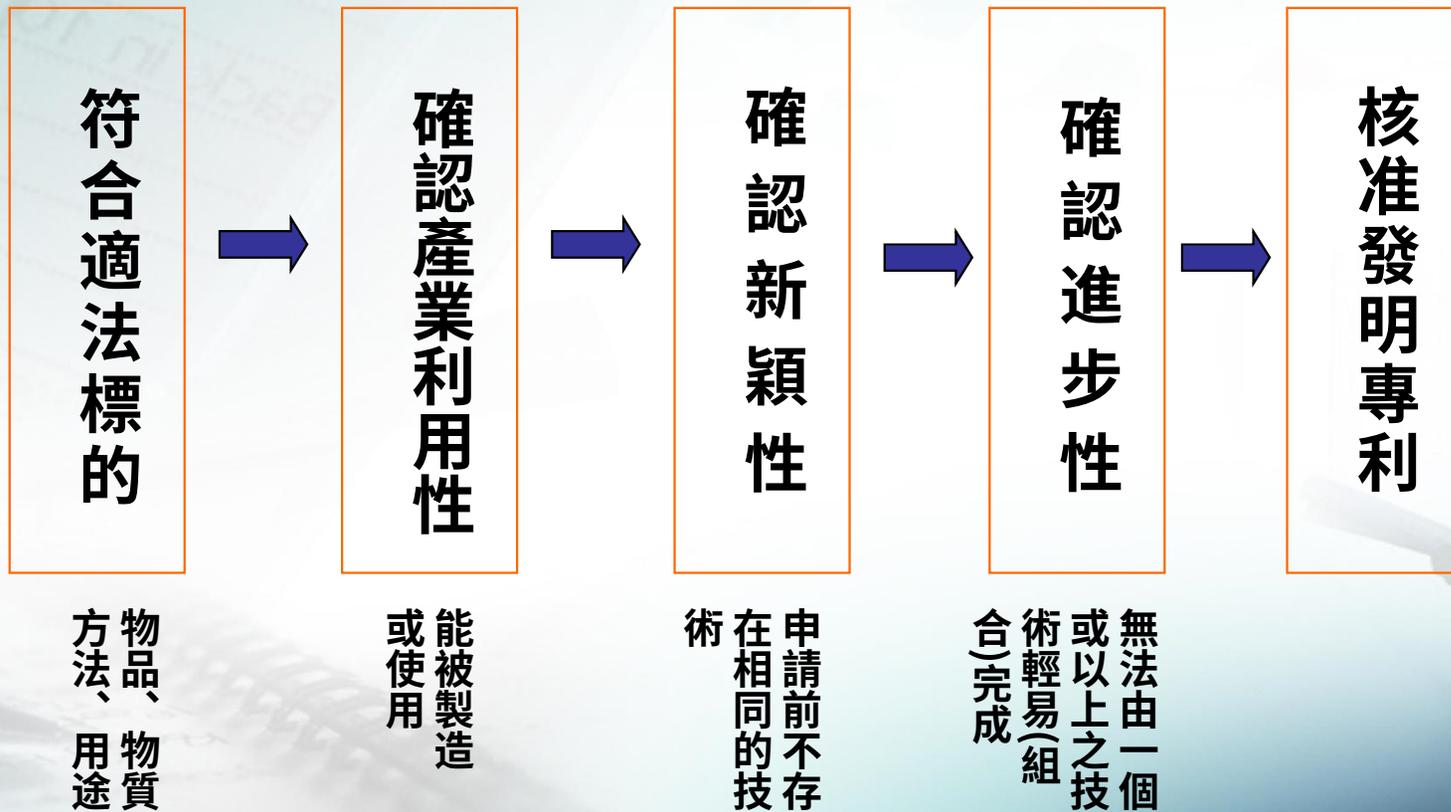


# 發明專利實體要件

產業利用性、新穎性、進步性



# 發明專利實審流程



# 發明專利之三要件1

專利法第 22 條第 1 項前段：**產業利用性**

凡可供產業上利用之發明…

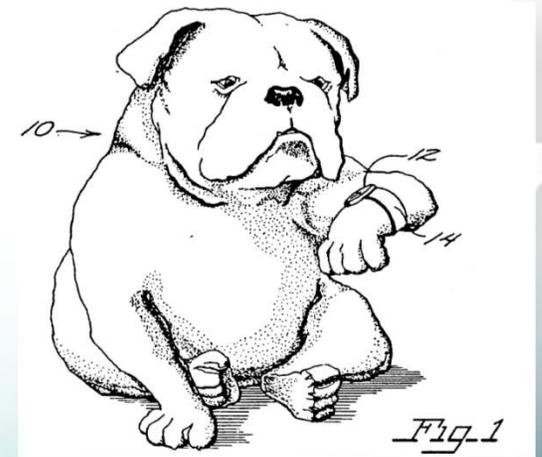
=> 可被運用於工業上，可以量產，可以重複實施



Dean Kamen's Ginger- Segway



Uno Motorcycle- Segway



Dog Watch  
(time rate other than human time)

# 發明專利之三要件2

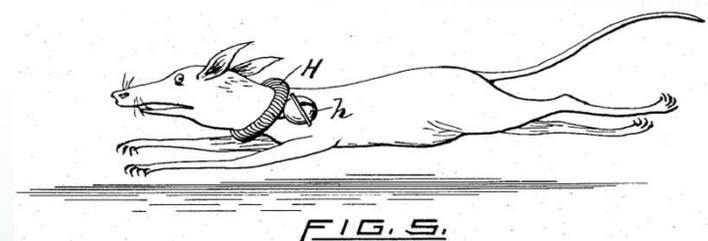
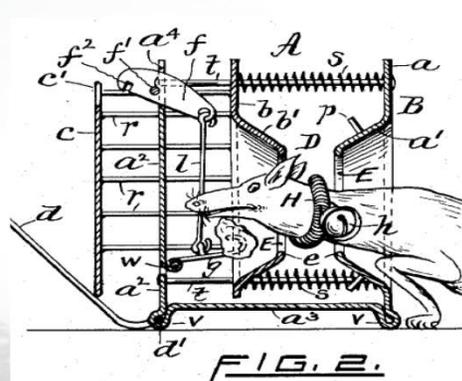
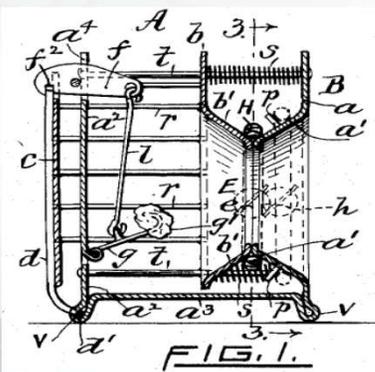
## ➤ 專利法第22條第1項：**新穎性**

無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前**已見於刊物者**
- 二、申請前**已公開實施者**
- 三、申請前**已為公眾所知悉者**



現有捕鼠器



Attaching Bell to Rat !

與現有捕鼠器不同  
(不捕捉,而使老鼠因鈴聲而自行離去)

# 新穎性概念(有沒有差異?)

- **申請前**是否已見於刊物? 已公開實施? 已為公眾所知悉者?  
(亦即**是否與先前技術存在差異** → 有差異, 即有新穎性)
- 是否與**申請在先而在其後才公開或公告**之專利所附說明書或圖式載明之內容相同者 (擬制新穎性)? (僅限同TW專利前案, 同申請人除外)
- 引證案是否能**單獨揭示**申請案一獨立項之技術特徵? (單獨對比)
- 單件引證之**全部內容**皆可用以比對申請案之請求項 (若引證為專利, 則可引用請求項及說明書內文)
- 比對項目:**技術領域, 欲解決技術問題, 技術方案及區別特徵, 欲達成之技術效果**等...是否相同

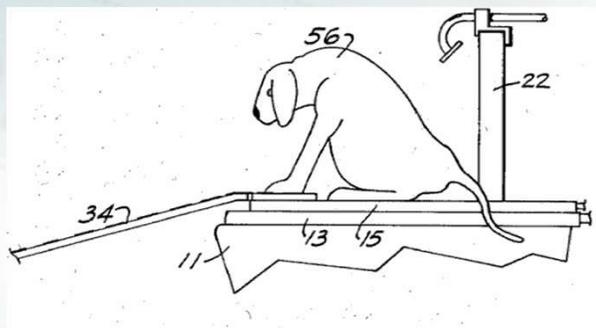


A 專利申請早於 B 專利, 故 B 專利不具新穎性(擬制新穎性)

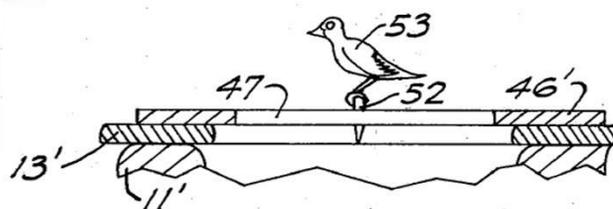
# 發明專利之三要件3

專利法第 22 條第 2 項：**進步性**

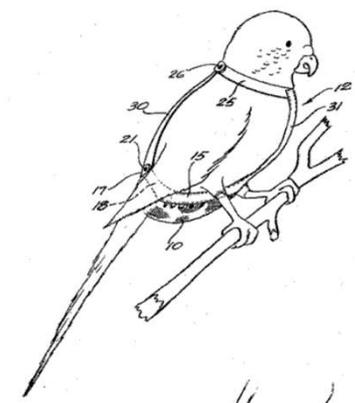
發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。



Dog Toilet Seat



Bird Toilet Seat



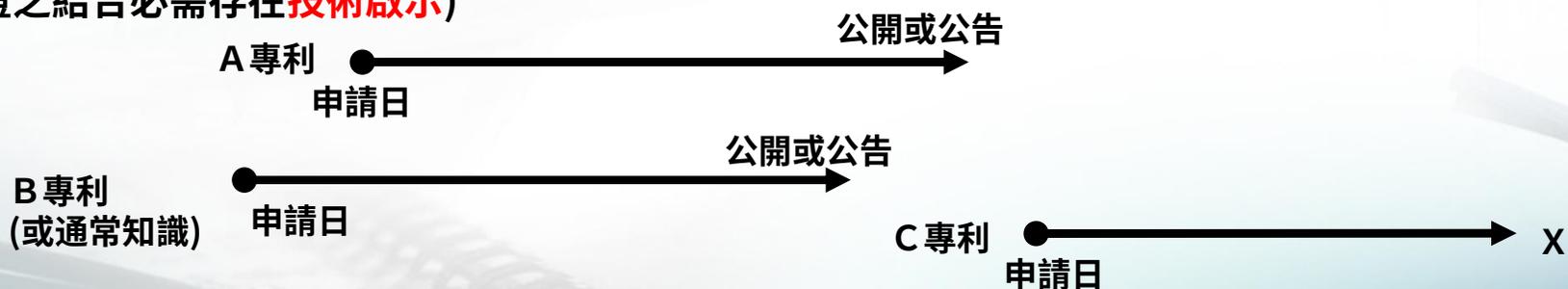
鳥用尿布

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後於十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。

# 進步性概念 (有差異，但能輕易完成?)

是否為相同或相似**技術領域**，是否互補揭示**所有組成要件之基本技術特徵/區別特徵**，是否解決相同**技術問題**，是否達成**相同技術效果**，即相對申請前之**先前技術**是否**能被輕易完成**?

- 申請案一獨立項與一**最接近的引證案**之間雖存在有**差異特徵**，但是：
  - 1.是否可由**組合其他引證**而輕易完成申請案該差異特徵之技術概念及功效?；或
  - 2.是否可由**組合通常知識**而輕易完成申請案該差異特徵之技術概念及功效?
- 各引證之**全部內容**皆可用以**組對比對**申請案之請求項 (若引證為專利，則可引用請求項及說明書內文)(但引證之結合必需存在**技術啟示**)



A及B專利公告 (或公開) 皆早於C專利，且兩者可輕易組合，並可完成C專利技術概念及功效，故C專利不具進步性

# 發明申請案例 1

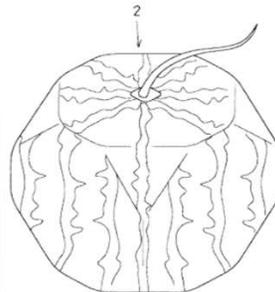
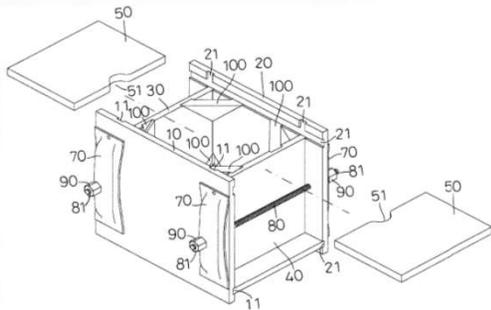
▶ 若你是專利審查員，是否會核准其發明專利權？



Google  
可攜式搜尋面板  
(透明面板+  
後攝影鏡頭+  
無線網路+  
影像搜尋比對功能+  
影像/文字資料庫)

# 發明申請案例 2

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其發明專利權？



各種特殊形狀之西瓜(x)  
或西瓜之塑形殼體(o)

# 發明申請案例3

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其發明專利權？

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 106912338 A  
(43) 申请公布日 2017.07.04

(21) 申请号 201710125627.3

(22) 申请日 2017.03.04

(71) 申请人 杜宏来

地址 100076 北京市丰台区东高地红星北里甲3栋庚门702

(72) 发明人 杜宏来

(51) Int. Cl.

A01G 15/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图15页

(54) 发明名称

煽除雾霾方案

(57) 摘要

本发明提供了一种解除雾霾的组织实施方案，在受雾霾影响期间的城市和地区，可以用人工按指定的方向，在统一的时间内共同煽除城市和地区的雾霾，具有成本低、效果显著的特点，并且不会二次环境污染。人工煽除雾霾可产生非常强大的风力和风量。以北京市为例：如果有1500万人参加为煽除雾霾而进行的造风运动，并在相同的时间内向相同的方向煽动除霾扇，则可建立起强大的风压，迫使带有雾霾颗粒的空气向同一方向流动起来，在1小时内至少可将10800亿立方米的空气定向推移1米，等同于把40米高、20公里长、20公里宽的地面低层空气顺着风向，在1小时内定向推移了68公里，而北京市城8区的面积也只有396平方公里（相当于20公里长、20公里宽），这种风力足够将首都刚刚形成的轻度雾霾移出北京城，并避免重度雾霾发生。



CN 106912338 A

煽除雾霾方案(x)

# 新型專利 Utility Model Patent



各種親子自行車改良  
(可選擇申請新型或發明)

# 新型專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

妨害公共秩序或善良風俗

約2~6個月

專利核准

專利公告

只有公告號、沒有公開號  
公告號: **M329611**  
(Utility Model)

(非必要)

新型專利技術報告

行使專利權(訴訟)時  
需主動提示技術報告

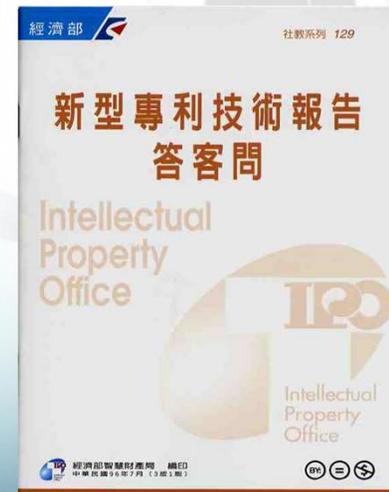
# 新型專利技術報告

➤ 申請專利之新型經**公告**後，**任何人**得向專利專責機關申請**新型專利技術報告**。

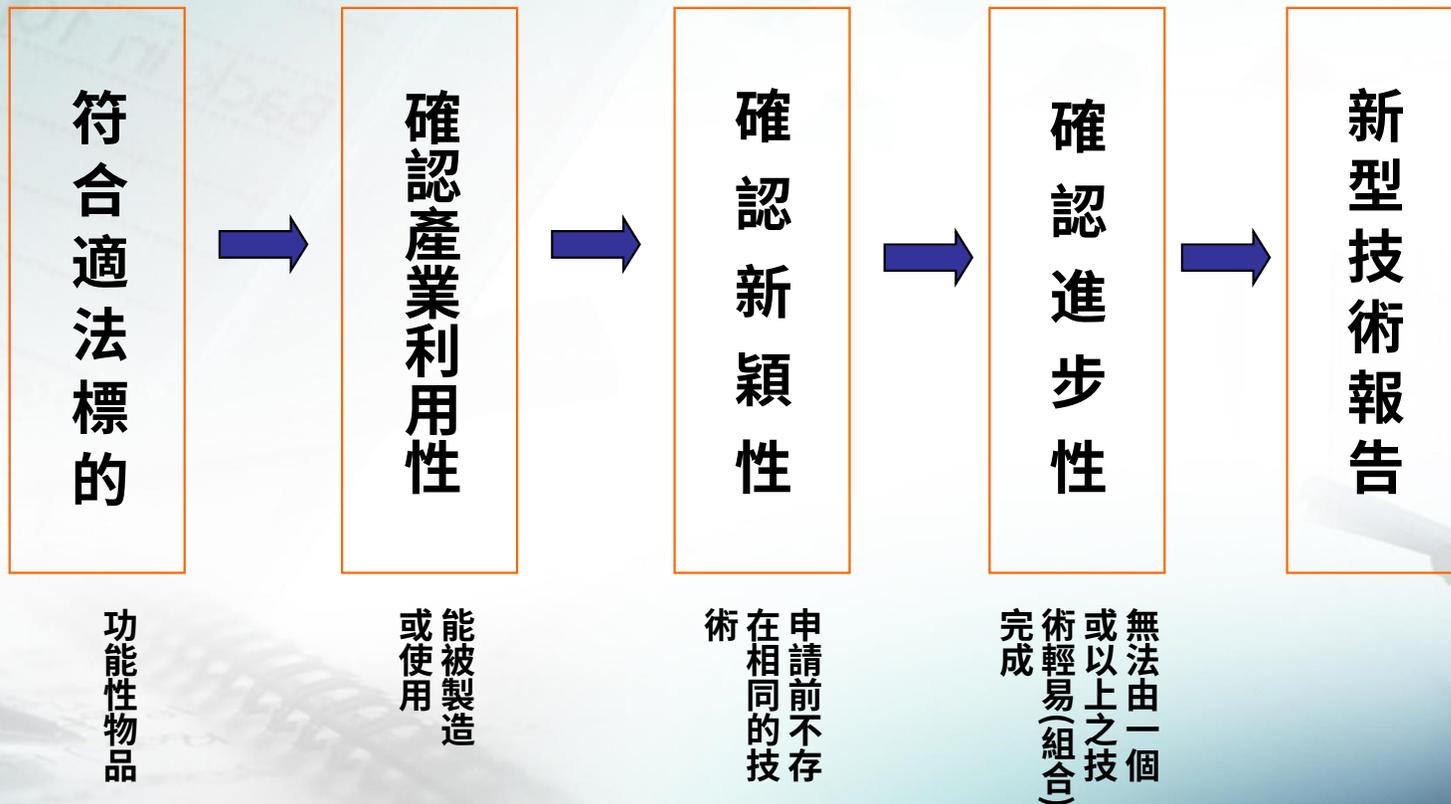
依專利法第 116 條之規定，新型專利權人行使新型專利權時，如**未提示**新型專利技術報告，**不得進行警告**

新型專利技術報告之性質，並非行政處分，就其案件無拘束機關之效力，僅作為新型專利權人權利行使或技術利用之參考。

即使其否定新型專利之新穎性或進步性等實體要件，在依法定程序(舉發)撤銷其新型專利前，專利權仍屬有效



# 新型技術報告確認流程



# 新型申請案例 1

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其新型專利權？



車輛翹牌器



瑞士迷你槍(Swiss Mini Gun)  
具擊發功能

理論上可以申請,但可能另有妨害公共秩序或善良風俗問題

# 新型申請案例 2

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其新型專利權？



各種親子自行車改良

# 設計專利 Design Patent



Pretec I-Disk Sushi  
握壽司造型  
隨身碟



水果造型  
便條紙

# 設計專利如何界定範圍？

➤ 設計專利之保護範圍即圖式所示之形狀、  
花紋、色彩或其結合

需附各面視圖：

立體圖

右側視圖

俯視圖

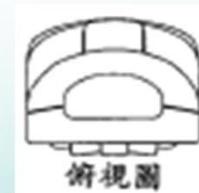
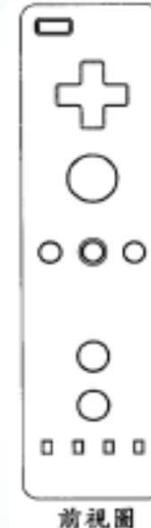
前側視圖

仰視圖

左側視圖

後側視圖

(使用示意圖)



# 設計專利簡要申請程序

專利申請



實體審查



專利核准



專利公告

純功能性之物品造形(x)

純藝術創作(x)

積體電路電路布局及電子電路布局(x)

物品妨害公共秩序或善良風俗(x)

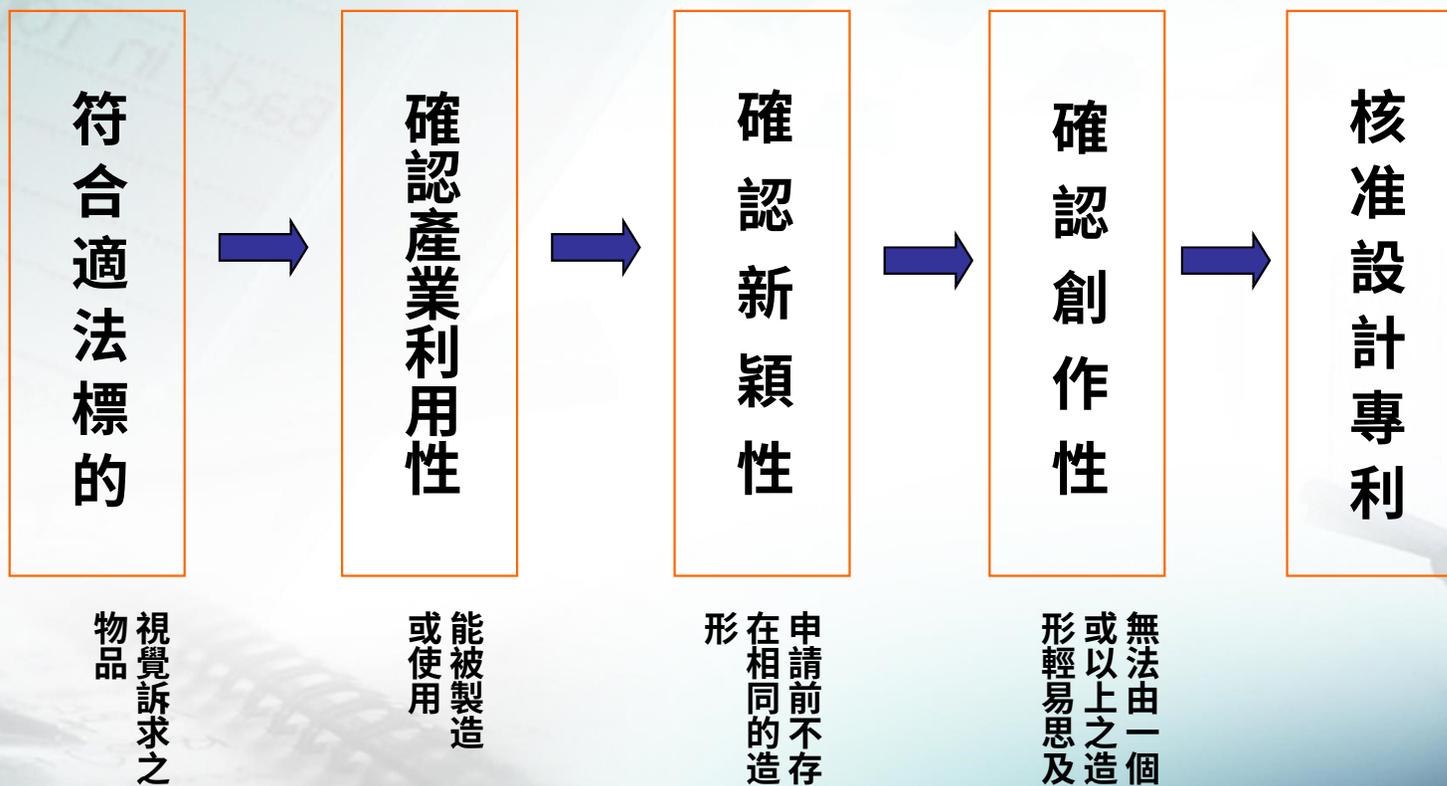
只有公告號,沒有公開號

公告號:D114380

(Design)

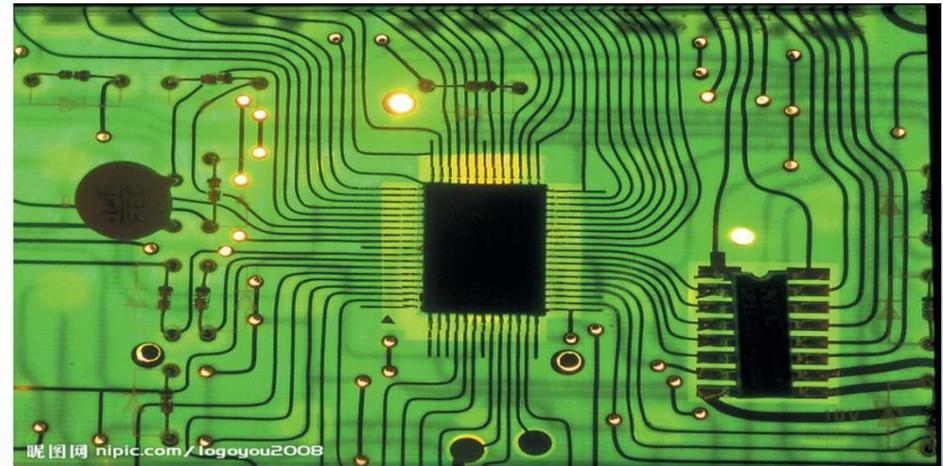
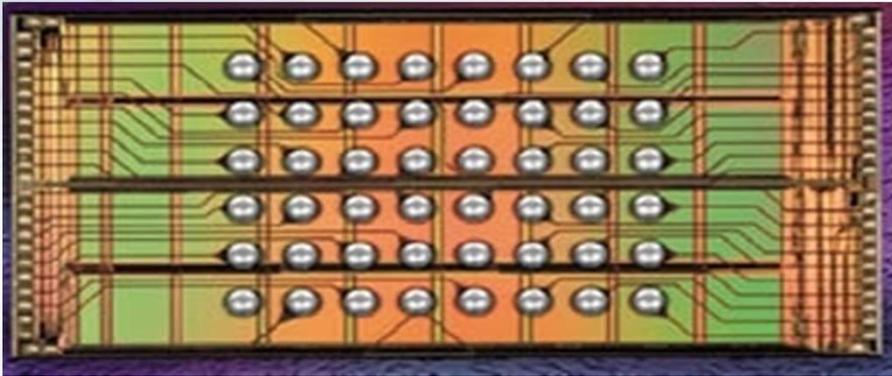


# 設計專利實審流程



# 設計專利申請案例 1

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其設計專利權？



各種集成電路或電路板之佈局圖案

# 設計專利申請案例 2

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其設計專利權？

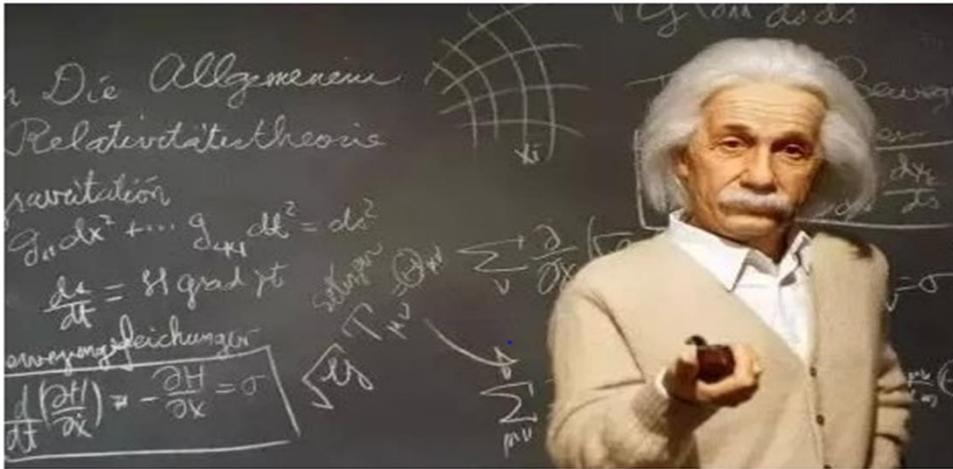


金磚造型的  
USB隨身碟 (U盤)

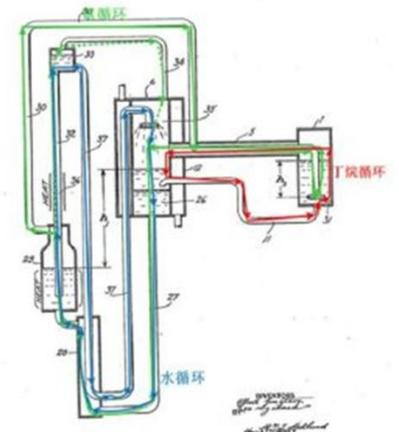


Pretec I-Disk Sushi  
握壽司造型  
隨身碟

## 愛因斯坦



愛因斯坦大學畢業最開始沒有找到好工作，後來被介紹到專利局當專利審查員，他在專利局工作了5年，上午的上班時間審查專利，下午的時間進行物理研究，在專利局工作期間提出了狹義相對論。



愛因斯坦有一項發明專利“利用空氣壓縮製冷的冰箱”，無需加氟，而是採用氨、丁烷和水

# 專利說明書 簡介

(申請人委託事務所撰寫並提交給專利局之正式文件)



# 專利說明書

## 專利法第25條：

(1) 申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式，向專利專責機關申請之。

## 專利法第26條：

(1) 說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

(2) 申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

(3) 摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

# 專利申請所需文件(以發明為例)

1. 申請書 (request, 基本資料)
2. 摘要 (abstract, 或設計專利之簡要說明)
3. 說明書 (specification, 詳細技術說明)
4. 申請專利範圍 (claim, 以文字界定保護範圍)  
(設計專利之圖式即為申請專利範圍)
5. 圖式及代表圖 (drawing, 繪製示意圖)
6. 委任書 (power of attorney, 委託事務所代理申請及答辯等程序)



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 發明說明書公開本

(11) 公開編號：TW 201015070 A1

(43) 公開日：中華民國 99 (2010) 年 04 月 16 日

(21) 申請案號：098133137

(22) 申請日：中華民國 98 (2009) 年 09 月 30 日

(51) Int. Cl.： G01N35/08 (2006.01) G01N33/48 (2006.01)

(72) 優先權：2008/10/01 南韓 10-2008-0096724

(71) 申請人 三星電子股份有限公司 (南韓) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)  
南韓

(72) 發明人 李凡石 LEE, BEOM SEOK (KR)；金智苑 KIM, JI WON (KR)；李延健 LEE, JEONG GUN (KR)；金貴炫 KIM, KUI HYUN (KR)

(74) 代理人：戴復彥

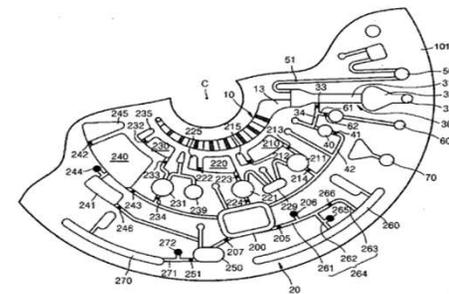
申請實體審查：有 申請專利範圍項數：15 項 圖式數：10 共 68 頁

(54) 名稱

植基於離心力的微流體裝置和其製造方法以及利用微流體裝置測試樣本的方法  
CENTRIFUGAL-BASED MICROFLUIDIC APPARATUS, METHOD OF FABRICATING THE SAME,  
AND METHOD OF TESTING SAMPLES USING THE MICROFLUIDIC APPARATUS

(57) 摘要

提供一種微流體裝置，包含一微流體結構用以提供接收一流體的複數個空間，複數個管道用以讓該流體流動，以及複數個活門用以控制該流體在該複數個管道的流動。該微流體結構包含一樣本腔，一樣本隔離單元，一測試單元，和一品質控制腔。該樣本隔離單元，用以從該樣本腔接收一樣本且利用一離心力從該樣本中分離一表層物，該測試單元從該樣本隔離單元接收該表層物，然後利用一抗原抗體反應來偵測一檢體，該品質控制腔用以確認該測試的可靠度。



- 10：樣本腔
- 11：入口
- 12：接收部
- 13：出口
- 14：逆流防止單元
- 19a：側邊
- 19b：側邊
- 20：測試單元
- 30：樣本隔離單元
- 31：表層物收集單元
- 31a：梯狀部分
- 32：沉澱物收集單元
- 33：平時關閉活門
- 34：管道
- 35：第一品質控制腔
- 40：表層物度量腔

第2A圖

# 申請書

—用以填寫**申請人及發明人基本資料**並請求各種程序項目

注意事項：

1. **請求實質審查**：申請時可勾選同時請求實審(或申請後3年內再決定)
2. **發明名稱**：參考欲保護之claim範圍，擬定一廣義名稱即可，且必需指明標的是構造、裝置、設備、方法、組成物或用途
3. **主張優惠期**：申請日前**12/6個月內**公開，需註明公開日及提供證明文件
4. **主張利用生物材料**：要勾選為須寄存或不須寄存之生物材料，前者需提供國內或國外寄存資訊並提供證明文件(申請後4個月內/最早優先權日後16個月內)
5. **主張國內/國外優先權**：註明國家(地區)、申請日、申請案號
6. **加收規費**：申請專利範圍超過**10項**，每項加收800元



# 申請書

聲明本人就相同創作在申請本發明專利之同日，另申請新型專利。

## 五、說明書頁數、請求項數及申請規費：

摘要：( 2 )頁，說明書：( 15 )頁，申請專利範圍：( 2 )頁，  
圖式：( 5 )頁，合計共( 24 )頁。

申請專利範圍之請求項共( 10 )項，圖式共( 10 )圖。

規費：共計新台幣 9,700 元整。(規費請參見申請須知)

本案未附英文說明書，但所檢附之申請書中發明名稱、申請人姓名或名稱、發明人姓名及摘要同時附有英文翻譯者，可減收申請規費。

## 六、外文本種類及頁數：(不須填寫的部分可自行刪除)

外文本種類： 日文  英文  德文  韓文  法文  俄文  
 葡萄牙文  西班牙文  阿拉伯文

外文本頁數：外文摘要、說明書及申請專利範圍共( )頁，圖式( )頁，合計共( )頁。

## 七、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

- 1、摘要一式 3 份。
- 2、說明書一式 3 份。
- 3、申請專利範圍一式 3 份。
- 4、必要圖式一式 3 份。
- 5、委任書 1 份。
- 6、外文摘要一式 2 份。
- 7、外文說明書一式 2 份。
- 8、外文申請專利範圍一式 2 份。
- 9、外文圖式一式 2 份。
- 10、優先權證明文件正本及首頁影本各 1 份、首頁中譯本 2 份。
- 11、優惠期證明文件 1 份。
- 12、生物材料寄存證明文件：  
 國外寄存機構出具之寄存證明文件正本 1 份。

國內寄存機構出具之寄存證明文件正本 1 份。

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之證明文件 1 份。

13、如有影響國家安全之虞之申請案，其證明文件正本 1 份。

14、其他：

## 八、個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認本申請案之附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。



# 摘要

一應簡要敘明發明所揭露之內容，並以所欲解決之**問題**、解決問題之**技術手段**以及**主要用途**  
注意事項：

1. **字數限制**：以不超過250字為原則
2. **指定代表圖**：最能代表該發明技術特徵之圖式，並列出符號說明
2. **代表化學式**：若有，應揭示最能顯示發明特徵之化學式
3. **英文摘要**：發明專利建議附註英摘（非必要）

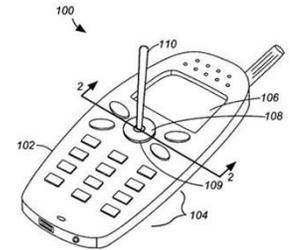


FIG. 1

可插上做為方向搖桿之觸控筆及手機

# 摘要

## 發明摘要

※ 申請案號：

※ 申請日：

※IPC 分類：

### 【發明名稱】(中文/英文)

半導體封裝構造

SEMICONDUCTOR PACKAGE STRUCTURE

### 【中文】

一種半導體封裝構造，其包含一晶片承載件、至少二半導體晶片及數個電性連接部。該晶片承載件具有一承載表面與一相對於該承載表面之一背面。該半導體晶片係堆疊配置於該晶片承載件之承載表面，並以該電性連接部使該半導體晶片與該晶片承載件形成電性連接。藉此，提高每單位之半導體封裝構造的電路與元件之組裝密度。

### 【英文】

A semiconductor package structure is described and includes a chip carrier, at least two semiconductor chips, and a plurality of electrical connection elements. The chip carrier has a supporting surface and a rear surface opposite to the supporting surface. The semiconductor chips are stacked with each other on the supporting surface of the chip carrier, and electrically connected to the chip carrier through the electrical connection elements. As a result, the assembly density of integrated circuits and components in per unit of semiconductor package structure can be increased.

### 【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（ 2 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

20 晶片承載件	201 承載表面
202 背面	21a 半導體晶片
21b 半導體晶片	22 黏著層
23 間隔層	24a 電性連接部
24b 電性連接部	26 封裝膠體
28 導電元件	

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：

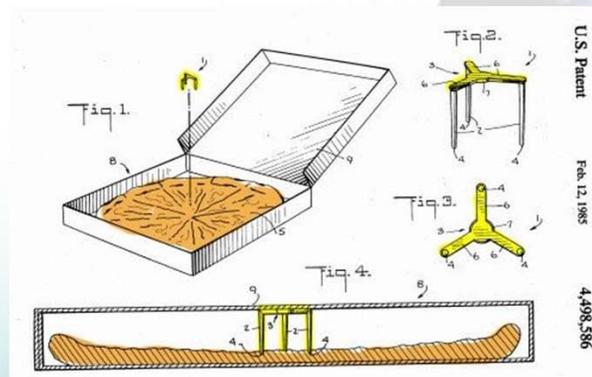


# 說明書

一用以**明確且充分之揭露**，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並**可據以實現**

包含下述章節：

- 1.發明名稱
- 2.技術領域
- 3.先前技術
- 4.發明內容
- 5.圖式簡單說明(無圖,則可省略)
- 6.實施方式
- 7.元件符號說明(無圖,則可省略)
- 8.生物材料寄存資訊(限生技案,無則可省略)
- 9.序列表(限生技案,無則可省略)



披薩盒內支撐器

# 說明書-發明名稱

- 應**與其申請專利範圍內容相符**，不得冠以無關之文字
- 應**明確、簡要**指定申請專利之標的，並反映其**範疇**，例如**物（構造、裝置、設備、組成物）、方法或用途**

例如：

半導體封裝構造

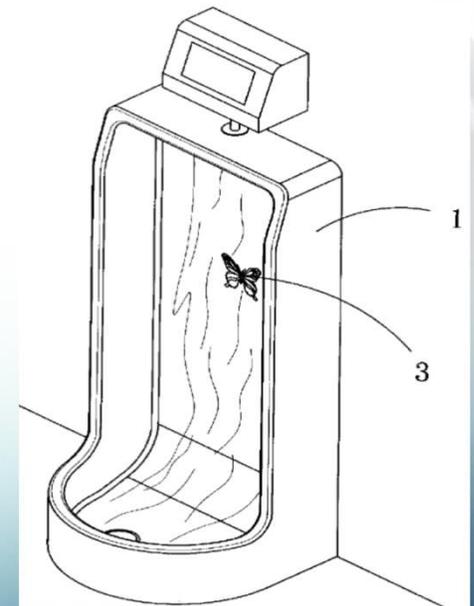
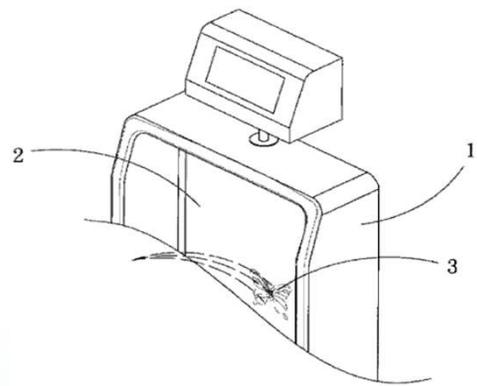
筆記型電腦散熱裝置

具感溫變色圖形之尿斗

3D影像處理方法

治療肝癌之醫療組成物

將XX化合物應用於治療胃潰瘍之用途



# 說明書-技術領域

—應為申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域

—通常限定一廣義領域及一狹義領域

例如：

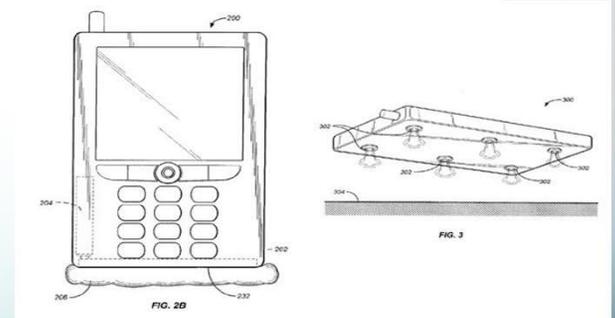
**本發明係關於**一種半導體封裝構造，**特別是關於**一種用以堆疊數個半導體晶片之半導體封裝構造。

本發明係關於一種阻燃塗料及阻燃織物，特別是關於一種無鹵素成份之塗佈型阻燃塗料及阻燃織物。

本發明係關於一種同軸式凸輪變速機構，特別是關於一種具有多種輸入/輸出傳動方式之同軸式凸輪變速機構。

# 說明書-先前技術

- 一應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而為在於先前技術中的**問題或缺失**，記載內容儘可能**引述**該先前技術文獻之名稱，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係。
- 一先前技術可以是單純文字描述說明、搭配習用圖示說明，或引用既有專利說明。
- 一先前技術中的**問題或缺失**用以引出本發明相較之下**欲解決的問題及訴求的有益效果**



亞馬遜的手機墜落時自動打開安全氣囊，或以噴射氣流緩降

# 說明書-先前技術

## 發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

### 【發明名稱】(中文/英文)

半導體封裝構造

SEMICONDUCTOR PACKAGE STRUCTURE

### 【技術領域】

【0001】 本發明係關於一種半導體封裝構造，特別是關於一種用以堆疊數個半導體晶片之半導體封裝構造。

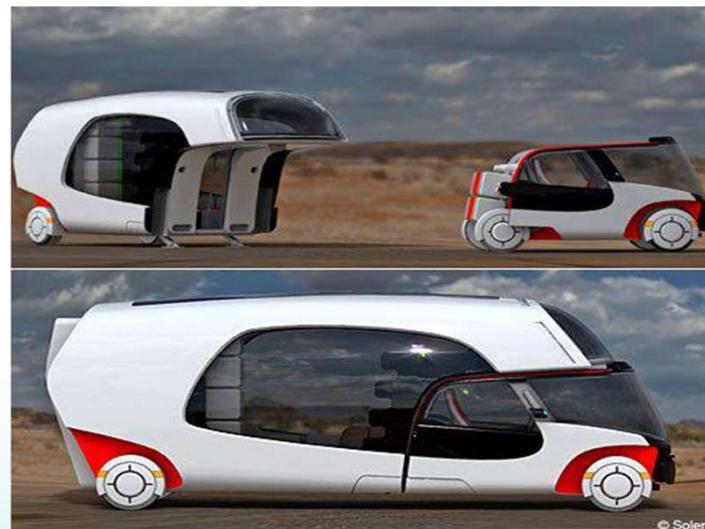
### 【先前技術】

【0002】 習用單晶片之半導體封裝構造，如第 1 圖所示，其包含一晶片承載件 10、一半導體晶片 11、一黏著層 12、一電性連接部 13、一封裝膠體 14 及數個導電元件 15。該晶片承載件 10 具有一承載表面 101 與一相對於該承載表面 101 之一背面 102，其中該半導體晶片 11 藉由一黏著層 12 接合至該晶片承載件 10 之承載表面 101 上，並利用該電性連接部 13 將該半導體晶片 11 電性連接至該晶片承載件 10。該封裝膠體 14 用以將該半導體晶片 11 及電性連接部 13 包覆於該晶片承載件 10 之承載表面 101 上。該導電元件 15 則以陣列型態配置於該晶片承載件 10 之背面 102 上。

【0003】 再者，中華民國公告第 I888168 號發明專利揭示一種「晶片封裝構造」，其包含一晶片、一導線架、數條錫線及一封裝膠體，其中該晶片設於該導線架之一晶片承座上，且該晶片之一主動表面具有數個接墊。該錫線用以電性連接該接墊至該導線架之數個引腳。該封裝膠體用以包覆該晶片、晶片承座、錫線及引腳之內端，藉此構成一晶片封裝構造。

【0004】 然而，上述各種習用半導體封裝構造在實際使用上仍具有下述問題：由於每一該晶片承載件 10 僅能承載單一該半導體晶片 11，因此無法進一步降低每單位之半導體封裝構造的封裝成本，且亦難以進一步提高其電路與元件之組裝密度。再者，在一電子產品之印刷電路板上必需焊接數個半導體封裝構造，才能提供數個半導體晶片 11 的多樣化功能，其不利於電子產品的小型化趨勢。

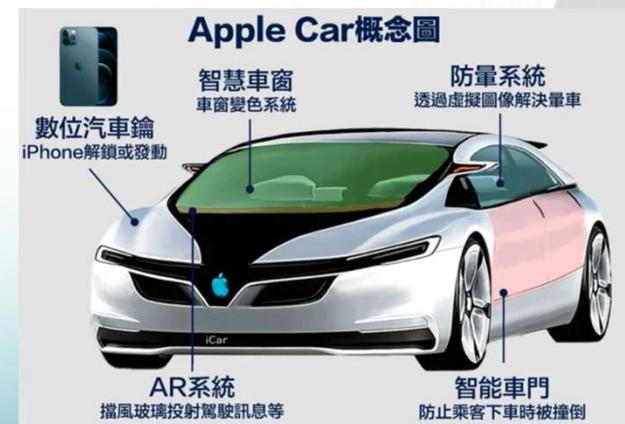
【0005】 故，有必要提供一種半導體封裝構造，以解決習知技術所存在的問題。



可分離式旅行車及拖車

# 說明書-發明內容

- 發明內容包含三部分：發明所欲解決之**問題**、解決問題之**技術手段**及對照先前技術之**功效**
- 撰寫發明內容時，應以綜合的形式記載該三項內容及三者之間的對應關係，無須就三者分項撰寫
- 可列多一個或以上之**發明目的**
- 提供的技術方案基本上寫法對應於申請專利範圍即可，以對其提供說明書的**文字支持**



# 說明書-發明內容

## 【發明內容】

【0006】 本發明之主要目的在於提供一種半導體封裝構造，其係藉由將數個半導體晶片堆疊於同一晶片承載件上，以提高每單位之半導體封裝構造的電路及元件之組裝密度，進而有利於降低封裝成本。

【0007】 本發明之次要目的在於提供一種半導體封裝構造，其中單一個半導體封裝構造可提供數個半導體晶片之多樣化電路功能，進而有利於增加產品功能性及縮減產品體積。

【0008】 為達上述之目的，本發明提供一種半導體封裝構造，其包含：一晶片承載件，其具有一承載表面與一相對於承載表面之背面；一第一半導體晶片，其配置於該晶片承載件之承載表面上；一第二半導體晶片，其堆疊配置於該第一半導體晶片上；數個第一電性連接部，其係將該第一半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上；及數個第二電性連接部，其係將該第二半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上。

【0009】 在本發明之一實施例中，該晶片承載件係可選自基板或導線架。

【0010】 在本發明之一實施例中，該晶片承載件之背面設有數個導電元件。

【0011】 在本發明之一實施例中，該導電元件係選自錫球、針腳或引腳。

【0012】 在本發明之一實施例中，該晶片承載件之周圍設有數個導電元件。

【0013】 在本發明之一實施例中，該導電元件係為引腳。

【0014】 在本發明之一實施例中，該第一及第二半導體晶片之間設置有一間隔層。

【0015】 在本發明之一實施例中，該間隔層選自膠帶、黏著劑或絕緣板體。

【0016】 在本發明之一實施例中，該絕緣板體選自空白晶片或預先成型之封裝膠塊。

【0017】 在本發明之一實施例中，該第一及第二電性連接部係為錫線。

【0018】 在本發明之一實施例中，該第一電性連接部為覆晶凸塊，及該第二電性連接部為錫線。

【0019】 在本發明之一實施例中，該第一電性連接部為錫線，及該第二電性連接部為覆晶凸塊。

【0020】 在本發明之一實施例中，該第二半導體晶片經由該第一半導體晶片電性連接至該晶片承載件。

【0021】 再者，本發明提供另一種半導體封裝構造，其包含：一晶片承載件，其具有一承載表面；至少二半導體晶片，其相互堆疊配置於該晶片承載件之承載表面上；數個電性連接部，其分別將該半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上；及一封裝膠體，其用以將該半導體晶片及該電性連接部包覆於該晶片承載件之承載表面上。



瞌睡感測器(仿生物視網膜晶片)

# 說明書-圖式簡單說明

一有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式

例如：

## 【圖式簡單說明】

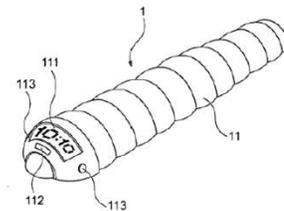
【0022】

第 1 圖：習用單晶片半導體封裝構造之剖視圖。

第 2 圖：本發明第一實施例之半導體封裝構造之剖視圖。

第 3 圖：本發明第二實施例之半導體封裝構造之剖視圖。

第 4 圖：本發明第三實施例之半導體封裝構造之剖視圖。



可移動爬行之鬧鐘

# 說明書-實施方式

- 原則上應記載一個以上之**實施方式**，詳敘申請專利範圍中所載之**必要技術特徵**，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即**能瞭解**申請專利之發明的內容，並**可據以實施**。
- 記載必要技術特徵時，應詳細記載其內容，不得僅引述先前技術文獻或說明書中之其他段落
- 對於申請專利之發明與先前技術有**區別的技术特徵**及附屬項中的**附加技術特徵**，均應詳細記載。
- 必要時得以**實施例**說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。

# 說明書-實施方式

24b、一封裝膠體 25 及數個導電元件 26，本發明將於下文利用第 2 至 4 圖逐一詳細說明第一實施例之上述各元件的細部構造、組裝關係及其運作原理。

【0025】 請參照第 2 圖所示，本發明第一實施例之晶片承載件 20(chip carrier)較佳選自基板(substrate)，但並不限於此，本發明之晶片承載件 20 亦可選自導線架(lead-frame)或其他可供承載晶片之等效構造等。該晶片承載件 20 具有一承載表面 201 與一相對於該承載表面 201 之一背面 202。當該晶片承載件 20 選自基板時，其通常係一多層電路板，且該多層電路板之承載表面 201 與背面 202 係分別具有數個表面電路。

【0026】 請參照第 2 圖所示，本發明第一實施例之第一半導體晶片 21a 具有一主動表面(未標示)相對遠離該晶片承載件 20，且該主動表面之唇緣處具有數個接墊(未標示)。該第一半導體晶片 21a 另具有一背面，其係藉由該黏著層 22 接合至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上。在本實施例中，該黏著層 22 係可選自膠帶或黏著劑。再者，該第二半導體晶片 21b 具有一主動表面(未標示)相對遠離該第一半導體晶片 21a，該主動表面之唇緣處具有個接墊(未標示)。該第二半導體 21b 另具有一背面，其係藉由該間隔層 23 以堆疊方式設置在該第一半導體晶片 21a 之上方。

【0027】 請再參照第 2 圖所示，本發明第一實施例之間隔層 23 較佳選自膠帶或黏著劑，但亦可選自絕緣板體，例如空白晶片(dummy chip)或預先成型之封裝膠塊。同時，該間隔層 23 亦可避免該第一及第二半導體晶片 21a、21b 之間產生靜電而造成的短路問題。再者，在本實施例中，該第一電性連接部 24a 及第二電性連接部 24b 較佳選自鐳線(bonding wire)，例如金線。該第一電性連接部 24a 用以將該第一半導體晶片 21a 之接墊電性連接至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上的表面電路(未繪示)；同理，該第二電性連接部 24b 則用以將該第二半導體晶片 21b 之接墊電性連接至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上的表面電路。

【0028】 請再參照第 2 圖所示，本發明第一實施例之封裝膠體 25 較佳選自環氧樹脂(epoxy)，其用以將該第一半導體晶片 21a、第二半導體晶片 21b、間隔層 23、第一電性連接部 24a 及第二電性連接部 24b 包覆於該晶片

## 【實施方式】

【0023】 為了讓本發明之上述及其他目的、特徵、優點能更明顯易懂，下文將特舉本發明較佳實施例，並配合所附圖式，作詳細說明如下。再者，本發明所提到的方向用語，例如上、下、頂、底、前、後、左、右、內、外、側面、周圍、中央、水平、橫向、垂直、縱向、軸向、徑向、最上層或最下層等，僅是參考附加圖式的方向。因此，使用的方向用語是用以說明及理解本發明，而非用以限制本發明。

【0024】 請參照第 2 圖所示，本發明第一實施例之半導體封裝構造係包含一晶片承載件 20、一第一半導體晶片 21a、一第二半導體晶片 21b、一黏著層 22、一間隔層 23、數個第一電性連接部 24a、數個第二電性連接部



# 說明書-實施方式

承載件 20 之承載表面 201 上。再者，該導電元件 26 係可選自鉚球(ball)、針腳(pin)或引腳(lead)，其較佳係以陣列型態配置於該晶片承載件 20 之背面 202 上。

【0029】請再參照第 2 圖所示，當組裝本發明第一實施例之半導體封裝構造時，首先藉由該黏著層 22 將該第一半導體晶片 21a 接合至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上。接著，利用該第一電性連接部 24a 將該第一半導體晶片 21a 之接墊電性連接至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上的表面電路。藉由該間隔層 23 之媒介，將該第二半導體 21b 堆疊設置在該第一半導體晶片 21a 之上方。利用該第二電性連接部 24b 將該第二半導體晶片 21b 之接墊電性連接至該晶片承載件 20 之承載表面 201 上的表面電路。接著，藉由該封裝膠體 25 將該第一半導體晶片 21a、第二半導體晶片 21b、間隔層 23、第一電性連接部 24a 及第二電性連接部 24b 包覆於該晶片承載件 20 之承載表面 201 上。最後，將該導電元件 26 以焊接方式配置於該晶片承載件 20 之背面 202 上。藉此，即完成本發明之多晶片半導體封裝構造。

【0030】再者，值得注意的是，在本實施例中，該間隔層 23 之尺寸較佳設計成不致接觸該第一半導體晶片 21a 之主動表面的接墊；且該間隔層 23 之厚度需設計成能提供足夠高度，以避免該第二半導體晶片 21b 之背面壓損該第一半導體晶片 21a 之接墊及第一電性連接部 24a。另一方面，本發明亦可在同一晶片承載件 20 之承載表面 201 上設置三個或三個以上之半導體晶片。此時，各兩相鄰堆疊之半導體晶片之間皆需設置一個間隔層 23。此外，若該晶片承載件 20 選自導線架(未繪示)時，該導電元件 26 則選自引腳，且較佳配置於該晶片承載件 20 之周圍。

【0031】請參照第 3 圖所示，本發明第二實施例之半導體封裝構造係相似於本發明第一實施例，該第二實施例之半導體封裝構造包含一晶片承載件 30、一第一半導體晶片 31a、一第二半導體晶片 31b、一黏著層 32、一間隔層 33、數個第一電性連接部 34a、數個第二電性連接部 34b、一封裝膠體 35 及數個導電元件 36。該晶片承載件 30 具有一承載表面 301 及一相對於該承載表面 301 之一背面 302。相較於第一實施例，該第二實施例之第一電性連接部 34a 係進一步選自覆晶式接合(flip chip)之凸塊(bump)。

【0032】請再參照第 3 圖所示，本發明第二實施例之第一半導體晶片 31a 具有一主動表面(未標示)相對靠近該晶片承載件 20，該主動表面具有數個接墊(未標示)，其經由該第一電性連接部 34a 與該晶片承載件 30 之承載表面 301 上的表面電路(未繪示)形成電性連接。再者，該第一半導體晶片 31a 與晶片承載件 30 之間的其餘空間則填充該黏著層 32，該黏著層 32 係可選自黏著劑。該第二電性連接部 34b 係選自鉚線，其用以將該第二半導體晶片 31b 之一主動表面(未標示)的數個接墊(未繪示)電性連接至該晶片承載件 30 之承載表面 301 上的電路(未繪示)。

【0033】請參照第 4 圖所示，本發明第三實施例之半導體封裝構造係相似於本發明第一實施例，該第三實施例之半導體封裝構造包含一晶片承載件 40、一第一半導體晶片 41a、一第二半導體晶片 41b、一黏著層 42、一間隔層 43、數個第一電性連接部 44a、數個第二電性連接部 44b、一封裝膠體 45 及數個導電元件 46。該晶片承載件 40 具有一承載表面 401 及一相對於該承載表面 401 之一背面 402。相較於第一實施例，該第三實施例之第二電性連接部 44b 係進一步選自覆晶式接合(flip chip)之凸塊(bump)。

【0034】請再參照第 4 圖所示，本發明第三實施例之第二半導體晶片 41b 具有一主動表面(未標示)相對靠近該第一半導體晶片 41a，該主動表面具有數個接墊(未標示)，其經由該第二電性連接部 44b 與該第一半導體晶片 41a 之一主動表面(未標示)上的接墊(未繪示)形成電性連接。再者，該第一及第二半導體晶片 41a、41b 之間的其餘空間則填充該間隔層 42，該間隔層 42 係可選自黏著劑。該第一電性連接部 44a 係選自鉚線，其用以將該第一半導體晶片 41a 之主動表面(未標示)的其他接墊(未繪示)電性連接至該晶片承載件 40 之承載表面 401 上的電路(未繪示)。在本實施例中，該第二半導體晶片 41b 係經由該第一半導體晶片 41a 電性連接至該晶片承載件 40。

【0035】如上所述，相較於第 1 圖之習用單晶片封裝構造僅能承載單一晶片，導致半導體封裝構造之組裝密度與功能性受到限制之缺點，第 2 圖之本發明藉由堆疊至少二半導體晶片 21a 及 21b 於單一該晶片承載件 30 上，其確實能有效提高每單位之半導體封裝構造的電路及元件之組裝密度，進而有利於降低封裝成本及增加產品功能性。再者，在本發明中，由

# 說明書-實施方式

於單一個半導體封裝構造即可提供數個半導體晶片 21a 及 21b 之多樣化電路功能，因此可減少在一電子產品之印刷電路板上設置半導體封裝構造的總數，故確實有利於增加電子產品之功能性及縮減電子產品之體積。雖然本發明已以較佳實施例揭露，然其並非用以限制本發明，任何熟習此項技藝之人士，在不脫離本發明之精神和範圍內，當可作各種更動與修飾，因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

## 【符號說明】

### 【0036】

10 晶片承載件	101 承載表面
102 背面	11 半導體晶片
12 黏著層	13 電性連接部
14 封裝膠體	15 導電元件
20 晶片承載件	201 承載表面
202 背面	21a 第一半導體晶片
21b 第二半導體晶片	22 黏著層
23 間隔層	24a 第一電性連接部
24b 第二電性連接部	25 封裝膠體
26 導電元件	30 晶片承載件
301 承載表面	302 背面
31a 第一半導體晶片	31b 第二半導體晶片
32 黏著層	33 間隔層
34a 第一電性連接部	34b 第二電性連接部
35 封裝膠體	36 導電元件
40 晶片承載件	401 承載表面
402 背面	41a 第一半導體晶片

41b 第二半導體晶片
43 間隔層
44b 第二電性連接部
46 導電元件

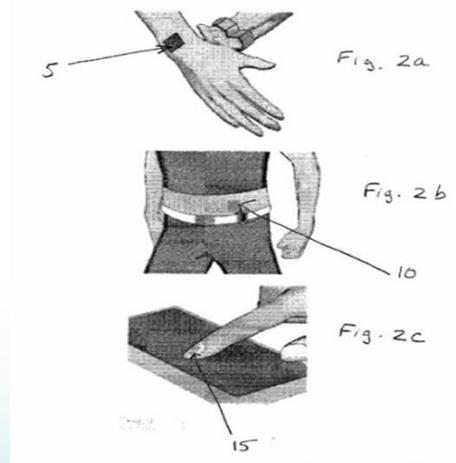
42 黏著層
44a 第一電性連接部
45 封裝膠體

## 【生物材料寄存】

國內寄存資訊【請依寄存機構、日期、號碼順序註記】

國外寄存資訊【請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記】

## 【序列表】(請換頁單獨記載)



**Nokia (諾基亞) 以刺青進行手機來電感應之裝置及方法**

# 說明書-元件符號說明

—有圖式者，應依圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明

例如：

10 晶片承載件

102 背面

12 黏著層

14 封裝膠體

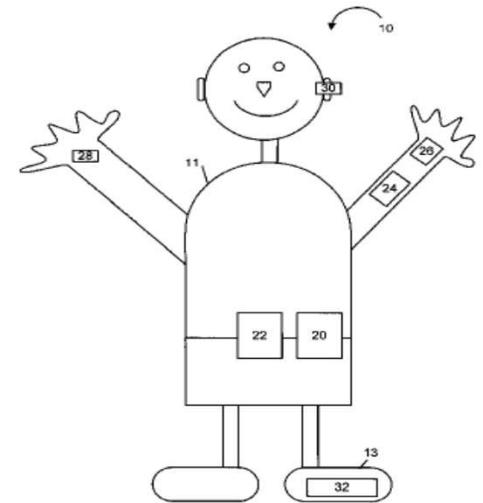
• • •

101 承載表面

11 半導體晶片

13 電性連接部

15 導電元件



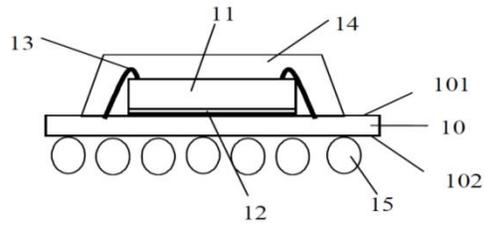
利用人體傳遞電力與  
訊息之方法

# 圖式

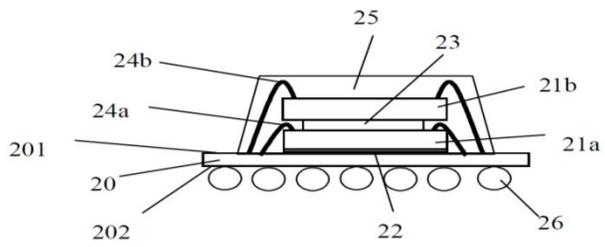
- 應參照**工程製圖**方法以**墨線繪製**清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節
- 如無法以工程製圖方法繪製，而僅能以**照片**呈現者，得以照片取代（新型申請案不可使用照片）
- 以照片取代時，若用**彩色照片**能更清楚呈現整體發明內容者，得以彩色照片取代，例如：金相圖、電泳圖、電腦照影影像圖、細胞組織染色圖、動物實驗效果比較圖等
- 應註明**圖號**（第N圖）及**元件符號**（註記符號所用之引出線不得交錯，同一部位在數圖中同時出現時應採用同一符號），除必要註記外(如方塊圖中)，不得記載其他說明文字。

# 圖式

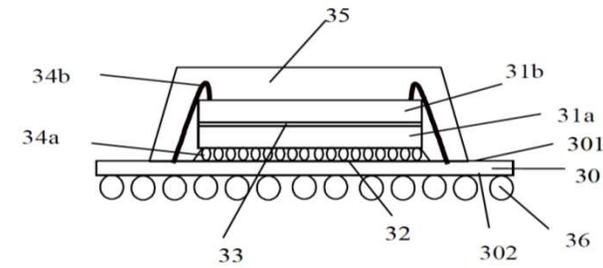
圖式



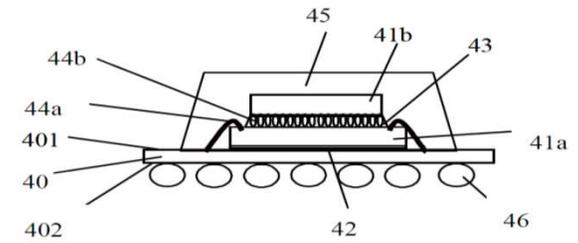
第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖



第 4 圖

# 申請專利範圍

- 得以一項或以上之**獨立項**表示
- 必要時，得有一項或以上之**附屬項**
- 獨立項、附屬項，應以其**依附關係**，依序以阿拉伯數字編號排列
- 各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須**為說明書所支持**

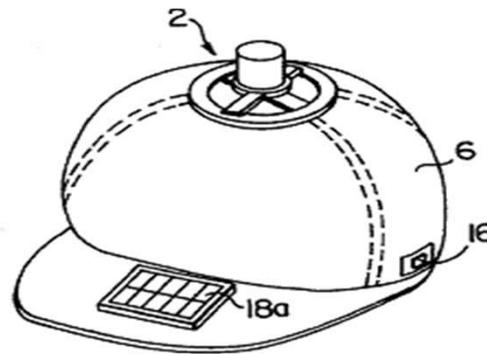
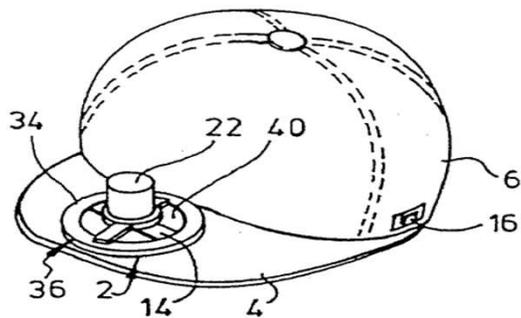
紙手機



# 申請專利範圍基本架構

## ➤ 申請專利範圍 (CLAIM) :

1. 可專利性的審查(或侵權與否的判斷)皆是以申請專利範圍界定的文字範圍為準。
2. 申請專利範圍書應當以說明書為依據(受說明書文字支持)，界定發明或者新型的區別技術特徵，清楚並簡要地限定請求保護的範圍。
3. 區別技術特徵可以是構成發明或者新型技術方案的組成要素，也可以是要素之間的組裝關係，方法的步驟或其順序，或組成物、用途等。



Claim的文字界定  
必需能突顯出本發明  
與現有技術之間的  
區別特徵

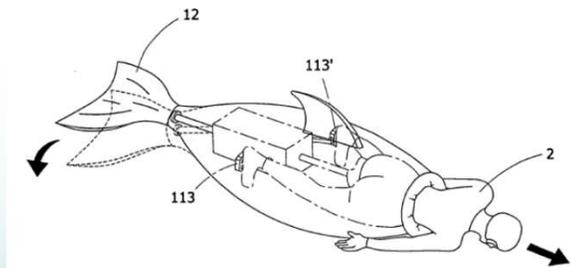
# 申請專利範圍

## 申請專利範圍

1. 一種半導體封裝構造，其包含：
  - 一晶片承載件，其具有一承載表面與一相對於承載表面之背面；
  - 一第一半導體晶片，其配置於該晶片承載件之承載表面上；
  - 一第二半導體晶片，其堆疊配置於該第一半導體晶片上；
  - 數個第一電性連接部，其係將該第一半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上；及
  - 數個第二電性連接部，其係將該第二半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該晶片承載件選自基板或導線架。 **=(1+2)**
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該晶片承載件之背面設有數個導電元件。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之半導體封裝構造，其中該導電元件係選自錳球、針腳或引腳。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該晶片承載件之周圍設有數個導電元件。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述之半導體封裝構造，其中該導電元件係為引腳。
7. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該第一及第二半導體晶片之間設置有一間隔層。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之半導體封裝構造，其中該間隔層選自膠帶、黏著劑或絕緣板體。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述之半導體封裝構造，其中該絕緣板體選自空白晶片或預先成型之封裝膠塊。
10. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該第一及第二電性連接部係為錳線。
11. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該第一電性連接部為覆晶凸塊，及該第二電性連接部為錳線。
12. 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體封裝構造，其中該第一電性連接部為錳線，及該第二電性連接部為覆晶凸塊。
13. 如申請專利範圍第 1 或 12 項所述之半導體封裝構造，其中該第二半導體晶片經由該第一半導體晶片電性連接至該晶片承載件。
14. 一種半導體封裝構造，其包含：
  - 一晶片承載件，其具有一承載表面；
  - 至少二半導體晶片，其相互堆疊配置於該晶片承載件之承載表面上；
  - 數個電性連接部，其分別將該半導體晶片電性連接至該晶片承載件之承載表面上；及
  - 一封裝膠體，其用以將該半導體晶片及該電性連接部包覆於該晶片承載件之承載表面上。

# 申請專利範圍的意義

- 公權力授與有限期間的**排他權利**，專有排除他人未經專利權人同意而實施發明/新型/設計之權利
- 政府與專利申請人之間的契約，為排他權利的**依據**(私益與公益之界線)
- 發明/新型專利權範圍，以申請專利範圍(claim, **請求項**)為準，於解釋申請專利範圍時，並**得審酌說明書及圖式**(不含摘要)
- 設計專利權範圍，以**圖式**為準，並**得審酌說明書**



人力水中推進器

# 設計專利如何界定範圍？

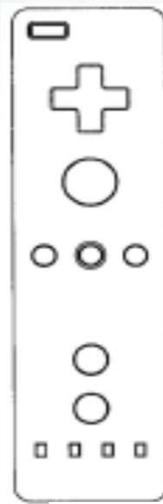
➢ 第 1 2 1 條：設計，指對物品之全部或部分之**形狀、花紋、色彩**或其結合，透過**視覺訴求**之創作。應用於物品之**電腦圖像及圖形化使用者介面**，亦得依本法申請設計專利。

**圖式即設計專利之保護範圍**

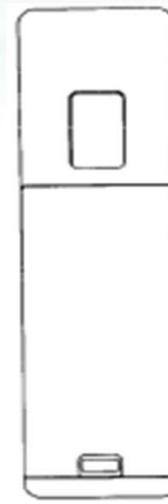
一般立體物品需附**六面正投影視圖**：  
前視圖（主視圖）、  
後視圖、  
左視圖、  
右視圖、  
俯視圖、  
仰視圖及  
立體圖。



立體圖



前視圖



後視圖



左視圖



右視圖



俯視圖



仰視圖

# 發明/新型專利如何界定範圍？

## ➤ 獨立項(independent claim):

1. **前言**: 寫明要求保護的發明技術方案的主題名稱

2. **連接詞**: 包含、包括… (通常使用開放式連接詞)

3. **主體**: 寫明發明區別於最接近的現有技術的**技術區別特徵**，以及實施發明所必要的**基本技術特徵**，共同限定發明要求保護的範圍。



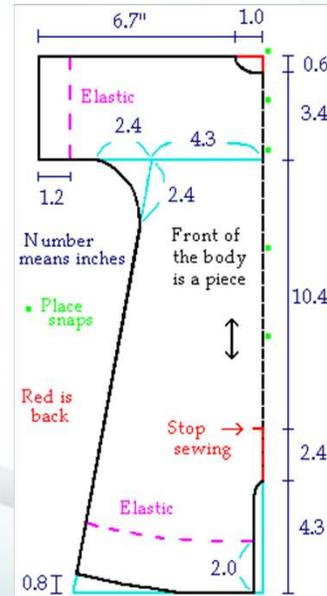
對一個新的產品設計  
要擬訂出適當的文字範圍  
既要區別于現有技術  
又不能自我過度局限

# 申請專利範圍之考量

- ✂ 申請專利時，獨立項最重要，因為**獨立項包含最少的限制要件**，所有附屬項都包含獨立項的限制要件
- ✂ 申請專利時，獨立項不要一開始就包含過度詳細的描述細節，以避免包含太多的限制要件
- ✂ 元件種類、元件數量、排列關係、步驟順序、元件名稱等都可能成為限制要件
- ✂ 在核駁答辯修正範圍時，獨立項所包含的限制要件通常是愈加愈多，使範圍愈修愈窄
- ✂ 在核駁答辯修正範圍時，若欲減少獨立項所包含的限制要件，則審查官必需擴大檢索範圍重新審查，故通常不被接受（但可提分案）

=>就像剪裁布料一樣，不要一開始就剪太多（加太多限制要件），剪掉了（範圍變窄了），在審查期間就很難再補回來（再變廣）

=>**核准範圍的廣或窄，是申請人與審查官對於申請案與先前技術之界線認定的拉据與妥協**



# 如何劃界及定義獨立項範圍

- 首先瞭解**先前技術(檢索)**，並客觀指出先前技術中的**問題或缺失**有那些
- 確定本發明理論上欲解決之問題及欲使用之**技術手段**有那些
- 確定本發明之技術手段與先前技術有那些**共有技術特徵**（即不具可專利性，需列於前言部份的特徵）
- 確定本發明之技術手段有那些有別於先前技術的**區別技術特徵**（即具可專利性，需列於特徵部份的特徵）
- 重新確定本發明的**區別技術特徵**實際能解決的問題剩下那些
- 由重新確定可解決的問題，來確定本發明最後**主要訴求的技術效果**



# 申請專利範圍

前言  
preamble

連接詞  
Transition

獨立項

1. 一種太陽能涼風帽構造，其包含：
  - 一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部，該遮陽部開設一開口；
  - 一太陽能板，其設於該頭套部及遮陽部之至少一個的上方；及
  - 一風扇，其對應設於該遮陽部之開口處，並電性連接該太陽能板。

附屬項

2. 如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該風扇係傾斜設於該開口處。
3. 如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該頭套部之後方另設有一對調整帶，以調整頭套部之內徑。

主體Body  
(條列式)

對照相關附圖及標號  
可以方便理解claim  
的文字範圍



# 申請專利範圍(較窄)

前言  
preamble

連接詞  
Transition

獨立項

1. 一種太陽能涼風帽構造，其包含：
  - 一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部，該遮陽部開設一開口；
  - 一太陽能板，其設於該頭套部及遮陽部之至少一個的上方；及
  - 一風扇，其對應設於該遮陽部之開口處，並電性連接該太陽能板。

附屬項

2. 如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該風扇係傾斜設於該開口處。
3. 如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該頭套部之後方另設有一對調整帶，以調整頭套部之內徑。

範圍較窄(限制要件多)

主體Body  
(條列式)

對照相關附圖及標號  
可以方便理解claim  
的文字範圍



# 申請專利範圍(較廣)

獨立項

- 1.一種太陽能涼風帽構造，其包含：
  - 一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部；
  - 一太陽能板，其設於該頭套部及遮陽部之至少一個的上方；及
  - 一風扇，其對應設於該遮陽部處，並電性連接該太陽能板。

範圍較廣  
(限制要件少)

附屬項

- 2.如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該遮陽部開設一開口，該風扇對應設於該遮陽部之開口處。
- 3.如請求項2所述之太陽能涼風帽構造，其中該風扇係傾斜設於該開口處。
- 4.如請求項1所述之太陽能涼風帽構造，其中該頭套部之後方另設有一對調整帶，以調整頭套部之內徑。

次要限制要件先  
寫到附屬項，以  
免獨立項太窄而  
容易被迴避

# 若專利申請後被核駁-

## 是否代表可專利性不足或說明書寫的不好?

### ➤ 影響專利核駁之內在因素:

說明書內容存在**格式上之錯誤** (形式核駁問題)

說明書內容技術**未能明確及充分揭露** (補充修正/實質變更問題)

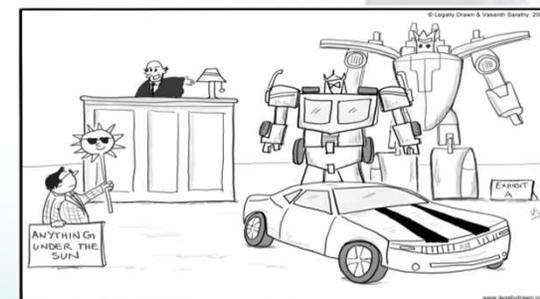
claim包含二個或以上之**不同發明** (發明單一性問題)

claim顯然**不可實施或欠缺實施之必要技術** (實用性問題)

claim**相同於單一先前技術** (新穎性問題)

claim相同於自己先前公開之**論文或期刊** (新穎性問題)

claim可由**二個或以上之先前技術輕易組合而成** (進步性問題)



# 若專利申請後被核駁-

## 是否代表可專利性不足或說明書寫的不好?

➤ 影響專利核駁之外在因素：  
審查官的**審查經驗、審查品質及檢索程度**

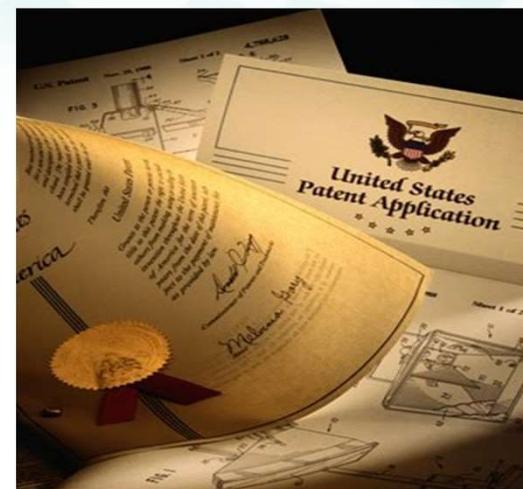
審查官對**進步性之主觀認定**

➤ 正確的專利申請觀念：  
申請案**收到第一次核駁通知是很常見的!**

申請案**沒有核駁就直接核准,不一定是好事**(範圍是否寫得太窄?)

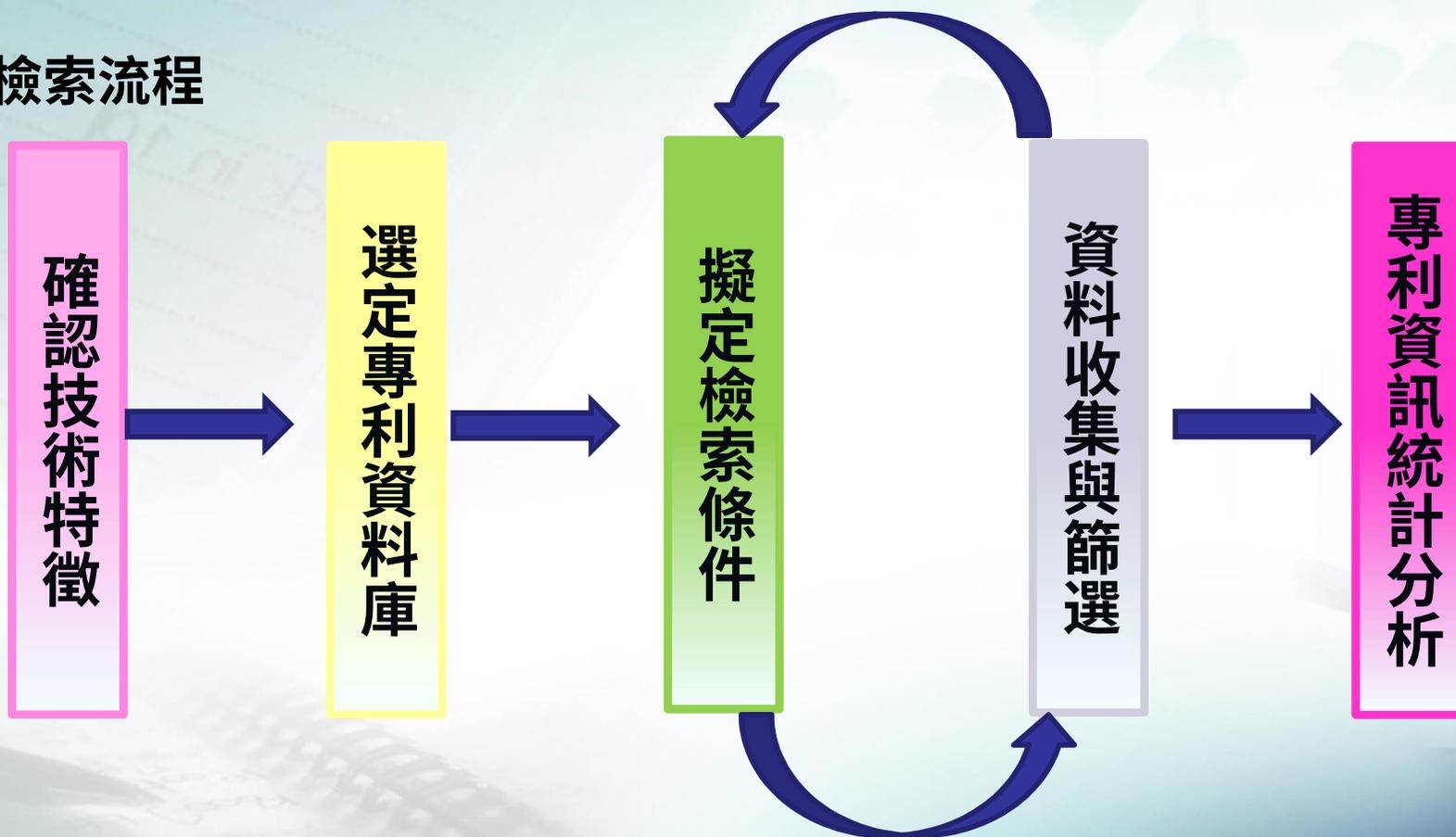
**核駁次數多寡與專利之品質或價值無絕對相關性**

=>申請專利範圍的撰寫和申請策略會因申請人申請目的不同(要**儘早核准**或**取得較廣範圍**)而有所不同!



# 專利資料庫檢索

## 一 檢索流程





# 專利資料庫

## ◆ 其他免費多國專利資料庫

### ◆ Google patent

### ◆ 全球專利檢索系統(TIPO提供)

採用全中文介面，使用者可於單一平台免費查詢台灣、美國、日本、歐洲、韓國、大陸及WIPO等專利局專利資料



全球專利檢索系統  
Global Patent Search System

號碼檢索 布林檢索 進階檢索 表格檢索 加值服務 標記清單

檢索及顯示設定

@ 全部欄位

AND  @ 全部欄位

AND  @ 全部欄位

AND  @ 全部欄位 +

AND  IPC =  IPC列表

AND  CPC =

AND  LOC =  LOC列表

AND  公開/公告日 =  年  月  日 -  年  月  日

前次檢索條件

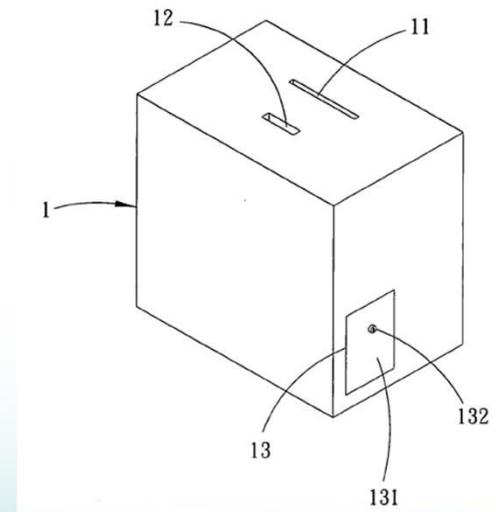
查詢 清除 再檢索 說明



# 擬定檢索條件

## 常用的檢索條件

- ◆ 發明名稱、摘要（多數資料庫支援）
- ◆ 申請專利範圍（少數資料庫支援此功能）
- ◆ 說明書全文（少數資料庫支援此功能）
- ◆ 申請人、發明人
- ◆ 申請、公開或公告之日期範圍
- ◆ 申請號、早期公開號、公告號、證書號
- ◆ 國際專利分類號（IPC）、美國專利分類號（UPC）



遲到要投入罰金才能打卡的打卡鐘

# 常用檢索技巧

- 多重欄位複合檢索
  - 如：名稱＋摘要＋申請日時間範圍…
- 關鍵字複合檢索
  - 如：(半導體 and 晶圓) and not (二極體)…
- 同義字替換檢索
  - 如：LED or “light emitting diode” …
- 引證案樹狀展開檢索
  - citation、reference by
- 同一申請人/發明人相關專利檢索
  - 如:xx大學/xxx (教授) 所申請過的專利
- 對檢索結果作再次篩選,或將多次結果放入資料夾後再作最後統計
  - 部份付費資料庫才有此功能,如: 智慧芽

# 檢索範例(以TW資料庫為例)



一種含有**蘆薈精油**的**護手軟膏**  
**藥膏**、**軟膏**、**凝膠**、...

# 摘要檢索

“摘要”欄位以“軟膏”為檢索條件

中華民國專利資訊檢索系統  
經濟部智慧財產局

首頁 分類瀏覽 專利檢索

布林檢索 Help

專利類型：發明 新型 新式樣/設計 公報類型：公開公報 專利公報

檢索去重(同一申請號有公告者去除公開) 一案兩請(同日申請發明及新型專利)

不限欄位：

Clear AND|OR|NOT ( ) 可點選選擇顯示符號來組合條件

AND ▾ 軟膏 @ 摘要

AND ▾ @ 專利編號

AND ▾ @ 專利編號

AND ▾ @ 專利編號

AND ▾ @ 專利編號

AND ▾ 公開/公告日 = 年 月 日 ~ 年 月 日

AND ▾ 國際分類號IPC=

AND ▾ 國際工業設計分類號LOC=

查詢 清除 再檢索 檢索條件範例

前次檢索條件：(軟膏)@AB

條列式簡目欄位：專利編號 公告/公開日 申請號 專利名稱 證書號 申請日 國際分類號

設計分類號 公報卷期 發明人 申請人 代理人 優先權 參考文獻

摘要 簡圖 原件影像 被參考次數

表格式簡目欄位：(公開/公告號+公開/公告日+申請號+專利名稱+申請人+圖式)

簡目顯示格式：條列式 英文單複數：關閉 每頁顯示筆數：10 表格式每列筆數：3

# 檢索列表

序號	專利編號	公告/公開日	申請號	
★ <input type="checkbox"/> 11	I284128	2007/07/21	089127265	具有抗腫瘤作用之經取代N-苯甲基-3-基乙醛酸衍生物 SUBSTITUTED N-BENZYLINDOL-3-YLGLYOXYLIC ACI
★ <input type="checkbox"/> 12	I234470	2005/06/21	089113735	經皮吸收製劑 TRANSDERMAL ABSORBABLE PREPARATION
★ <input type="checkbox"/> 13	I230608	2005/04/11	088104599	具抗腫瘤功效之-3-乙醛酸衍生物 INDOLYL-3-GLYOXYLIC ACID DERIVATIVES HAVING A
★ <input type="checkbox"/> 14	I226838	2005/01/21	089108597	改良之燒燙傷軟膏 配方及製法
★ <input type="checkbox"/> 15	552264	2003/09/11	087111867	大環內酯化物結晶,其製備方法及含彼之醫藥組合物
★ <input type="checkbox"/> 16	546014	2003/08/01	091305705	影音電腦(二)
★ <input type="checkbox"/> 17	509565	2002/11/11	089108025	淚道插管用裝置
★ <input type="checkbox"/> 18	467635	2001/12/01	089306795	片狀清潔劑(二)
★ <input type="checkbox"/> 19	442274	2001/06/23	089105621	急救用絆創膏
★ <input type="checkbox"/> 20	416854	2001/01/01	085112962	胰高血糖素樣促胰島 之經頰輸送

# 摘要內容

本創作係有關於一種「影音電腦(二)」，尤指一種家電化之優美立體曲線造形，精緻可愛，極具視覺親和力而令人愛不釋手之獨創外觀設計者。

如各附圖所示，本創作之「影音電腦(二)」包括有一電腦主機，該主機底部形成曲線起伏且而宛如軟膏之浮凸底座，側視觀之猶如雲形，並以背彎前直之方式向上微縮，而形成屏狀

=>檢索結果包含到技術領域差異大的前案

# 專利範圍檢索

“申請專利範圍”欄位以“軟膏”為檢索條件

專利類型：發明 新型 新式樣/設計      公報類型：公開公報 專利公報

檢索去重(同一申請號有公告者去除公開)    一案兩請(同日申請發明及新型專利)

不限欄位：

Clear AND OR NOT ( / ) 可點選運算元符號來組合條件

AND ▾ 軟膏 @ 專利範圍 ▾

AND ▾ @ 專利編號 ▾

AND ▾ 公開/公告日 ▾ = ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日 ~ ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日

AND ▾ 國際分類號IPC=

AND ▾ 國際工業設計分類號LOC=

查詢 清除 再檢索 檢索條件範例

# 檢索列表

序號	專利編號	公告/公開日	申請號	
★ <input type="checkbox"/> 181	565460	2003/12/11	087108408	利用柑橘萃取物來消除自由基的方法
★ <input type="checkbox"/> 182	550079	2003/09/01	086116105	用來控制及治療肛門直腸及結腸疾病之新穎藥學組合物及其製法
★ <input type="checkbox"/> 183	550256	2003/09/01	086112985	具有抗氣喘、抗過敏及免疫抑制/免疫調節作用之N-經取代□□-3-乙醛醯胺類
★ <input type="checkbox"/> 184	546133	2003/08/11	089118297	牙科治療用口腔護架
★ <input type="checkbox"/> 185	546148	2003/08/11	087107086	含有西印度櫻桃發酵物之皮膚美白組成物
★ <input type="checkbox"/> 186	516967	2003/01/11	087112364	包含有機酸以及西印度櫻桃發酵物或燕麥萃出物此二者的細胞更新率組成物
★ <input type="checkbox"/> 187	508785	2002/11/01	090122331	對準方法及裝置
★ <input type="checkbox"/> 188	504763	2002/10/01	088102462	用以磨光半導體晶圓表面之裝置
★ <input type="checkbox"/> 189	496744	2002/08/01	083105897	半固體藥學製劑及其製法
★ <input type="checkbox"/> 190	496957	2002/08/01	090130071	可密封與可操縱之預先充填的拋棄式移液管

# 申請專利範圍

## 申請專利範圍

15.如申請專利範圍第1項之裝置,尚包含軟膏供應機構,以供應磨光軟膏至該複數個磨光位置。

16.如申請專利範圍第15項之裝置,其中該等磨光軟膏係彼此不同。

17.如申請專利範圍第16項之裝置,其中該等磨光軟膏具有不同之PH值。

=>檢索結果包含到技術領域差異大的前案

# 檢索分類號(IPC)

根據初步檢索結果中技術領域相同的前案之IPC, 改以“IPC”欄位進行檢索

專利類型：發明 新型 新式樣/設計      公報類型：公開公報 專利公報

檢索去重(同一申請號有公告者去除公開)    一案兩請(同日申請發明及新型專利)

不限欄位：

[Clear](#) [AND](#) [OR](#) [NOT](#) ( ) > 可點選運算元符號來組合條件

AND ▼	<input type="text"/>	@ 專利編號 ▼
AND ▼	<input type="text"/>	@ 專利編號 ▼
AND ▼	<input type="text"/>	@ 專利編號 ▼
AND ▼	<input type="text"/>	@ 專利編號 ▼
AND ▼	<input type="text"/>	@ 專利編號 ▼
AND ▼	公開/公告日	= <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
AND ▼	國際分類號IPC=	A61K-009/06
AND ▼	國際工業設計分類號LCC=	<input type="text"/>

[查詢](#) [清除](#) [再檢索](#) 檢索條件範例

# 軟膏類似物

序號	專利編號	公告/公開日	申請號	
★ <input type="checkbox"/> 1	I605110	2017/11/11	098121637	新穎脂質二肽以及膠體 NOVEL LIPID DIPEPTIDE AND GEL
★ <input type="checkbox"/> 2	I581807	2017/05/11	102105646	烷烴混合物及其製造方法 PARAFFIN MIXTURE AND MANUFACTURING METHOD
★ <input type="checkbox"/> 3	I539975	2016/07/01	099138789	基質型貼劑及其製造方法 MATRIX-TYPE PATCH PREPARATION AND METHOD
★ <input type="checkbox"/> 4	I535460	2016/06/01	103145418	中草藥複方組成物及其應用 HERBAL COMPOSITION AND THE USE THEREOF
★ <input type="checkbox"/> 5	I527597	2016/04/01	097141313	局部組成物 TOPICAL COMPOSITION
★ <input type="checkbox"/> 6	I516281	2016/01/11	103124383	改良之鞣固劑製劑製法及所得之鞣固劑製劑 IMPROVED METHOD OF PRODUCING TANNIN PREPARATION
★ <input type="checkbox"/> 7	I476019	2015/03/11	102112362	接枝共聚物水凝膠及其製備方法 GRAFT COPOLYMER HYDROGEL AND PREPARATION METHOD
★ <input type="checkbox"/> 8	I465554	2014/12/21	097125585	新穎之脂質三肽性水凝膠化劑及水凝膠 NOVEL LIPID TRIPEPTIDIC HYDROGELLINIZING AGENT AND HYDROGEL
★ <input type="checkbox"/> 9	I417046	2013/12/01	095117101	使用於病人手術準備中的方法及組成物 METHOD AND COMPOSITION FOR USE IN SURGICAL PREPARATION OF PATIENT
★ <input type="checkbox"/> 10	I414296	2013/11/11	097131272	新穎之外用劑

# 申請專利範圍

無使用“軟膏”用語

## 摘要：

本發明之課題在於提供於酸性至鹼性的液性範圍中以極少量可形成水凝膠之水凝膠化劑以及具有高的環境、生物體適合性及生物分解性之水凝膠。

解決此課題之方法為式(1)：

(1)

(式中，R1表示碳原子數9至21的脂肪族基，R2、R3及R4各自獨立地表示氫原子、可有碳原子數1或2的支鏈之碳原子數1至4的烷基、苯基甲基或 $-(CH_2)_n-X$ 基，且R2、R3或R4中的至少一個表示 $-(CH_2)_n-X$ 基，n表示1至4之數，X表示胺基、胍基、 $-CONH_2$ 基、或可有1至3個氮原子的5員環或6員環或由5員環與6員環所構成的縮合雜環)所示的脂質肽或其鹽所成的水凝膠化劑及水凝膠。

## 申請專利範圍：

1. 一種水凝膠化劑，其特徵為由式(1)所示之脂質肽或其藥學上可使用的鹽所成；式(1)：式中，R1表示碳原子數9至21的脂肪族基，R2、R3及R4各自獨立地表示氫原子、可有碳原子數1或2的支鏈之碳原子數1至4的烷基、苯基甲基或 $-(CH_2)_n-X$ 基，且R2、R3或R4中的至少一個表示 $-(CH_2)_n-X$ 基，n表示1至4之數，X表示 $-CONH_2$ 基，或可有1至3個氮原子的5員環或6員環或由5員環與6員環所構成的縮合雜環。
2. 如申請專利範圍第1項之水凝膠化劑，其中該R1係可具有1或2個不飽和鍵的碳原子數11至17之直鏈狀脂肪族基。
3. 如申請專利範圍第1項或第2項之水凝膠化劑，其中該R2、R3及R4各自獨立地表示氫原子、甲基、乙基、異丙基、異丁基、第二丁基、苯基甲基或 $-(CH_2)_n-X$ 基，且R2、R3或R4中的一個或二個表示 $-(CH_2)_n-X$ 基，n表示1至4之數，X表示吡咯基、咪唑基、吡啶基或吡嗪基。
4. 如申請專利範圍第3項之水凝膠化劑，其中該R2、R3及R4各自獨立地表示氫原子、甲基、乙基、異丙基、異丁基、第二丁基、苯基甲基、2-胺基乙基、4-胺基丁基、4-胺基-吡咯甲基、咪唑甲基、吡啶甲基或3-吡嗪甲基，且R2、R3或R4中的一個或二個表示2-胺基乙基、4-胺基丁基、4-胺基-吡咯甲基、咪唑甲基、吡啶甲基或3-吡嗪甲基。
- ...
7. 一種纖維，其係由如申請專利範圍第1至6項中任一項之水凝膠化劑的自聚集所形成。
8. 一種水凝膠，其係由如申請專利範圍第1至6項中任一項之水凝膠化劑或如申請專利範圍第7項之纖維與水溶液或醇水溶液所成。

# 軟膏類似物>>再檢索

序號	專利編號	公告/公開日	申請號	申請名稱
★ 1	605110	2017/11/11	098121637	新穎脂質二肽以及膠體 NOVEL LIPID DIPEPTIDE AND GEL
★ 2	6581807	2017/05/11	102105646	烷烴混合物及其製造方法 PARAFFIN MIXTURE AND MANUFACTURE
★ 3	6539975	2016/07/01	099138789	基質型貼劑及其製造方法 MATRIX-TYPE PATCH PREPARATION AND
★ 4	6535460	2016/06/01		緩釋方組成物及其應用 SUSTAINED RELEASE COMPOSITION AND THE USE TH
★ 5	6527597	2016/04/01		組成物 COMPOSITION
★ 6	6516281	2016/01/11		羧基型製劑製法及所得之羧基型製劑 IMPROVED METHOD OF PRODUCING CARBOXYLIC
★ 7	6476019	2015/03/11		聚合物水凝膠及其製造方法 POLYMER COPOLYMER HYDROGEL AND PR
★ 8	6465554	2014/12/21		脂質三肽性水凝膠化劑及水凝膠 LIPID TRIPEPTIDIC HYDROGELLIN
★ 9	6417046	2013/12/01		用於病人手術準備中的方法及組成物 METHOD AND COMPOSITION FOR USE IN
★ 10	6414296	2013/11/11	097131272	新穎之外用劑

蘆薈  
精油  
護手

...

加入檢索條件，以找出最接近的先前技術

# 分類號(IPC)查詢

亦可直接至IPC查詢資料庫先查詢相關IPC分類號備用



The screenshot shows the website interface for the Intellectual Property Office (IPO). The header includes navigation links like '網站導覽', '常見問題', and '意見信箱'. The main content area is titled 'IPC 國際專利分類查詢' and features a search form with fields for '分類號' and '關鍵字', and a '查詢' button. Below the search form, there are '瀏覽方式' options: '完整' (selected) and '分層'. A table lists the classification levels A through H with their corresponding descriptions.

經濟部  
智慧財產局  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

國際專利分類查詢 >  
國際專利分類下載 >  
國際工業設計分類 >

網站導覽 常見問題 意見信箱 雙語詞彙 專業人士 English 中文 字級 小

便民服務 公告資訊 國際事務 認識智慧局 政府資訊公開 我想...

現在位置: 首頁 > 專利 > 國際專利分類 > 國際專利分類查詢

### IPC 國際專利分類查詢

分類號查詢瀏覽 版本差異表 請選擇版本: 2017.01版

分類號:  and 關鍵字:  查詢  
(關鍵字最多可輸入五個條件,+為 and,空格為 or。範例:A+B C)  
查詢結果筆數: 8

瀏覽方式  完整  分層

A	人類生活需要
B	作業、運輸
C	化學；冶金；組合化學
D	紡織；造紙
E	固定建築物
F	機械工程；照明；供熱；武器；爆破
G	物理
H	電學

摘自 <https://www.tipo.gov.tw/sp.asp?xdurl=mp/lpicFull.asp&ctNode=7231&mp=1>

# 分類號(IPC)查詢

A61K 8/98	●●●源自動物的 [8]
A61K 8/99	●●●來自藻類或真菌以外的微生物，例如：原生動物或細菌[2006.01,2017.01]
A61K 9/00	以特殊物理形態為特徵之醫藥配製品（核磁共振造影劑或磁共振成像造影劑見49/18；含有放射性物質之配製品見51/12）
A61K 9/02	●塞劑；栓劑；塞劑或栓劑之基質（製造裝置見A61J3/08；引入體內之設備見A61M31/00）
A61K 9/06	●軟膏劑；其基質（製造裝置見A61J3/04）
A61K 9/08	●溶液 [2,3]
A61K 9/10	●分散液；乳劑 [2,3]
A61K 9/107	●●乳劑 [5]

# 專利檢索應用宣導推廣

經濟部智慧財產局 · 網站導覽 · 資服組業務簡介

**經濟部智慧財產局**  
**專利商品化教育宣導網**

公告資訊 優質專利園地 商品化時事報導 供應/需求技術專區 **學習列車** 專利線上檢索

首頁 > 學習列車 > 專利檢索應用宣導推廣

## 專利檢索應用宣導推廣

### 106年「本國專利檢索策略與實機操作應用說明會」

課程名稱	主講人	課程地點	課程日期	瀏覽人次累計
本國專利檢索策略與實機操作應用	高佐良/組長	國立台北科技大學	2017/11/24	1167

### 103年度「專利資料庫檢索與應用」研討會

課程名稱	主講人	課程地點	課程日期	瀏覽人次累計
專利資料庫檢索與應用-台南場	鄭猷超/博士	國立台南生活美學館	2014/05/20	1150
專利資料庫檢索與應用-台中場	陳省三/博士	智慧財產局台中服務處	2014/05/29	1097

### 102年度「專利資料庫檢索與應用」研討會

課程名稱	主講人	課程地點	課程日期	瀏覽人次累計
生技應用領域之專利資訊檢索與應用	侯征宏/博士	智慧財產局台中服務處	2013/08/23	864
專利資料庫檢索與應用	陳省三/博士	智慧財產局高雄服務處	2013/07/30	1116

### 100年度「專利資料庫檢索與應用」研討會

摘自[http://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/01\\_classroom/promotion.aspx](http://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/01_classroom/promotion.aspx)



**ESSEN**

***Thank you***

**ESSEN Patent & Trademark Office**

**臺北、臺中、高雄、上海、深圳**

**高雄市苓雅區新光路38號24樓之2**

**TEL: 07-2692200**

